

本报告依据中国资产评估准则编制

中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支
付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司股东
全部权益价值评估项目
资 产 评 估 报 告

浙联评报字[2026]第 64 号

浙江中联资产评估有限公司

二〇二六年三月二十七日

目 录

声 明	1
摘 要	3
一、委托人及其他资产评估报告使用人	5
二、评估目的	42
三、评估对象和评估范围	43
四、价值类型	65
五、评估基准日	65
六、评估依据	66
七、评估方法	69
八、评估程序实施过程和情况	84
九、评估假设	85
十、评估结论	87
十一、特别事项说明	92
十二、评估报告使用限制说明	94
十三、评估报告日	95
附 件	97

声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象的可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

四、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。

五、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

六、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告

浙联评报字[2026]第 64 号

摘 要

浙江中联资产评估有限公司接受中微半导体设备（上海）股份有限公司的委托，就中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买杭州众硅电子科技有限公司 64.69%股权之经济行为，对所涉及的杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。

评估对象为杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益，评估范围为杭州众硅电子科技有限公司在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产及相关负债。

评估基准日为 2025 年 12 月 31 日。

本次评估的价值类型为市场价值。

本次评估以持续使用和公开市场为前提，考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法和市场法两种方法对杭州众硅电子科技有限公司进行整体评估，然后加以校核比较。考虑评估方法的适用前提及满足评估目的，本次选用市场法评估结果作为最终评估结论。

经实施资产核实、实地查勘、市场调查、评定估算等评估程序，得

出杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的评估结论如下：

合并报表口径下，杭州众硅电子科技有限公司在评估基准 2025 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益账面值 75,280.39 万元，评估值 250,140.00 万元，评估增值 174,859.61 万元，增值率 232.28%。

在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。

本报告中所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成，提请报告使用者注意。

根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须委托人按照法律法规要求履行资产评估监督管理程序后使用。评估结果使用有效期一年，即自 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 12 月 30 日使用有效。超过一年，需重新进行评估。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买资产涉及杭州众硅电子科技有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告

浙联评报字[2026]第 64 号

中微半导体设备（上海）股份有限公司：

浙江中联资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法、市场法，按照必要的评估程序，就中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金收购杭州众硅电子科技有限公司 64.69% 股权之经济行为，对所涉及的杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人及其他资产评估报告使用人

本次资产评估的委托人为中微半导体设备（上海）股份有限公司，被评估单位为杭州众硅电子科技有限公司。委托人为被评估单位的股东及股权拟收购方。

（一）委托人概况

公司名称：中微半导体设备（上海）股份有限公司

法定代表人：尹志尧

统一社会信用代码：913101157626272806

股票代码：688012

公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

注册资本：62,614.5307 万元

成立日期：2004 年 5 月 31 日

公司地址：上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号

经营范围：研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（二）被评估单位概况

1、企业基本情况

公司名称：杭州众硅电子科技有限公司

法定代表人：GU HAIYANG

统一社会信用代码：91330185MA2CC0D69L

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：11,562.0108 万元

成立日期：2018 年 5 月 23 日

公司地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道创业街 88 号 1 幢一层

经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、历史沿革及股东结构

(1) 2018年5月,杭州众硅设立

2018年5月21日,杭州众芯硅和朱琳签订《杭州众硅电子科技有限公司章程》,约定标的公司注册资本为3,000.00万元,朱琳以货币方式认缴出资30.00万元,占注册资本的1.00%。杭州众芯硅以货币方式认缴出资2,970.00万元,占注册资本的99.00%。

2018年5月23日,杭州众硅取得了杭州市临安区市场监督管理局核发的《营业执照》。

杭州众硅设立时的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,970.00	99.00%	货币
2	朱琳	30.00	1.00%	货币
合计		3,000.00	100.00%	--

(2) 2019年2月,杭州众硅第一次增资

2018年5月28日,杭州众硅与朱力昂及相关方签署增资协议,约定朱力昂对标的公司增资500.00万元,认缴标的公司116.13万元注册资本。

2019年1月,杭州众硅与临安创投及相关方签署增资协议,约定临安创投以1.00元/注册资本的价格对标的公司增资600.00万元,认缴标的公司600.00万元注册资本。

2019年2月21日,杭州众硅召开股东会并作出决议,同意标的公司注册资本增加至3,716.13万元,新增注册资本716.13万元由朱力昂认缴116.13万元,由临安创投认缴600.00万元,并相应修改公司章程。

2019年2月22日,杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后,杭州众硅的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,970.00	79.92%	货币

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
2	临安创投	600.00	16.15%	货币
3	朱力昂	116.13	3.13%	货币
4	朱琳	30.00	0.81%	货币
合 计		3,716.13	100.00%	--

（3）2019年12月，杭州众硅第二次增资

2019年6月17日，杭州众硅与淮堃创投及相关方签署增资协议，约定淮堃创投将以5,000.00万元的价格认购标的公司663.59万元注册资本。

2019年12月11日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至4,379.72万元，新增注册资本663.59万元由淮堃创投认缴。

2019年12月11日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,970.00	67.81%	货币
2	淮堃创投	663.59	15.15%	货币
3	临安创投	600.00	13.70%	货币
4	朱力昂	116.13	2.65%	货币
5	朱琳	30.00	0.69%	货币
合 计		4,379.72	100.00%	--

（4）2020年5月，杭州众硅第三次增资

2020年4月，杭州众硅与临安创投及相关方签署增资协议，约定临安创投将以1,000.00万元的价格认购标的公司132.72万元注册资本。

2020年5月5日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至4,512.44万元，新增注册资本132.72万元由临安创投认缴。

2020年5月22日,杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后,杭州众硅的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,970.00	65.82%	货币
2	临安创投	732.72	16.24%	货币
3	淮堃创投	663.59	14.71%	货币
4	朱力昂	116.13	2.57%	货币
5	朱琳	30.00	0.66%	货币
合计		4,512.44	100.00%	--

(5) 2021年1月,杭州众硅第一次股权转让

2021年1月12日,经杭州众硅股东会同意,杭州众芯硅与临安众芯硅(曾用名:宁波众硅企业管理合伙企业(有限合伙)(2021-01至2021-12))签订《股权转让协议》,约定将杭州众芯硅所持标的公司8.20%的股权(对应注册资本370.02万元,实缴0.00元)转让给临安众芯硅,转让价格为0.00元。后续由受让方履行实缴义务。标的公司现有股东均放弃优先购买权。

2021年2月,杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后,杭州众硅的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,599.98	57.62%	货币
2	临安创投	732.72	16.24%	货币
3	淮堃创投	663.59	14.71%	货币
4	宁波众硅	370.02	8.20%	货币
5	朱力昂	116.13	2.57%	货币
6	朱琳	30.00	0.66%	货币
合计		4,512.44	100.00%	--

(6) 2021年2月,杭州众硅第四次增资

2020年12月,杭州众硅与宁波领芯及相关方签署增资协议,约定

宁波领芯将以 2,000.00 万元的价格认购标的公司 265.44 万元注册资本。

2021 年 2 月 22 日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至 4,777.88 万元，新增注册资本 265.44 万元由宁波领芯认缴，并同意通过新的公司章程。

2021 年 2 月 22 日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	杭州众芯硅	2,599.98	54.42%	货币
2	临安创投	732.72	15.34%	货币
3	淮堃创投	663.59	13.89%	货币
4	宁波众硅	370.02	7.74%	货币
5	宁波领芯	265.44	5.56%	货币
6	朱力昂	116.13	2.43%	货币
7	朱琳	30.00	0.63%	货币
合 计		4,777.88	100.00%	--

（7）2021 年 3 月，杭州众硅第五次增资

2021 年 2 月，杭州众硅与炬华联昕、好奇号、寓鑫创投、吴仁德及相关方签署增资协议，约定炬华联昕、好奇号、寓鑫创投、吴仁德以 5,000.00 万元认购标的公司 597.24 万元注册资本。

2021 年 3 月 4 日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至 5,375.12 万元，新增注册资本 597.24 万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
炬华联昕	1,000.00	119.45
好奇号	500.00	59.72
寓鑫创投	1,000.00	119.45
吴仁德	2,500.00	298.62

合计	5,000.00	597.24
----	----------	--------

2021年3月4日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,599.98	48.37%
2	临安创投	732.72	13.63%
3	淮堃创投	663.59	12.35%
4	宁波众硅	370.02	6.88%
5	吴仁德	298.62	5.56%
6	宁波领芯	265.44	4.94%
7	炬华联昕	119.45	2.22%
8	寓鑫创投	119.45	2.22%
9	朱力昂	116.13	2.16%
10	好奇号	59.72	1.11%
11	朱琳	30.00	0.56%
合 计		5,375.12	100.00%

（8）2021年8月，杭州众硅第二次股权转让

2021年6月，杭州众芯硅与长兴青鸟签订投资协议，约定杭州众芯硅将其所持标的公司2.79%的股权（对应出资额150.00万元）转让给长兴青鸟，转让价格为1,320.00万元。

2021年7月21日，杭州众硅召开股东会，全体股东均同意前述股权转让。

2021年8月2日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	45.58%
2	临安创投	732.72	13.63%
3	淮堃创投	663.59	12.35%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
4	宁波众硅	370.02	6.88%
5	吴仁德	298.62	5.56%
6	宁波领芯	265.44	4.94%
7	长兴青鸟	150.00	2.79%
8	炬华联昕	119.45	2.22%
9	寓鑫创投	119.45	2.22%
10	朱力昂	116.13	2.16%
11	好奇号	59.72	1.11%
12	朱琳	30.00	0.56%
合 计		5,375.12	100.00%

（9）2021年10月，杭州众硅第六次增资

2021年8月，杭州众硅分别与江苏中小基金、毅达太湖、宁波毅达、嘉兴芯通、小满投资、宁波和丰、江苏赳泉、浙江容腾、苏州国发、朗玛四十二号及相关方签署增资协议，约定江苏中小基金、毅达太湖、宁波毅达、嘉兴芯通、小满投资、宁波和丰、江苏赳泉、浙江容腾、苏州国发、朗玛四十二号以17,000.00万元认购标的公司1,405.80万元注册资本。

2021年8月31日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至6,780.92万元，新增注册资本1,405.80万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
江苏中小基金	3,000.00	248.08
毅达太湖	1,500.00	124.04
宁波毅达	1,500.00	124.04
嘉兴芯通	3,000.00	248.08
小满投资	2,000.00	165.39
宁波和丰	3,000.00	248.08

江苏甌泉	1,000.00	82.69
浙江容腾	1,000.00	82.69
苏州国发	500.00	41.35
朗玛四十二号	500.00	41.35
合计	17,000.00	1,405.80

2021年10月11日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	36.13%
2	临安创投	732.72	10.81%
3	淮堃创投	663.59	9.79%
4	宁波众硅	370.02	5.46%
5	吴仁德	298.62	4.40%
6	宁波领芯	265.44	3.91%
7	江苏中小基金	248.08	3.66%
8	嘉兴芯通	248.08	3.66%
9	宁波和丰	248.08	3.66%
10	小满投资	165.39	2.44%
11	长兴青鸟	150.00	2.21%
12	毅达太湖	124.04	1.83%
13	宁波毅达	124.04	1.83%
14	炬华联昕	119.45	1.76%
15	寓鑫创投	119.45	1.76%
16	朱力昂	116.13	1.71%
17	江苏甌泉	82.69	1.22%
18	浙江容腾	82.69	1.22%
19	好奇号	59.72	0.88%
20	苏州国发	41.35	0.61%
21	朗玛四十二号	41.35	0.61%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
22	朱琳	30.00	0.44%
合计		6,780.92	100.00%

（10）2022年7月，第三次股权转让

2022年6月27日，公司召开股东会，同意临安创投将其持有的公司股权分别向杭州众诚芯、临安众硅、杭州芯匠进行转让：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价款（万元）
临安创投	杭州众诚芯	100.00	100.00
	临安众硅	289.00	289.00
	杭州芯匠	211.00	211.00

2022年6月，临安创投与杭州众诚芯、临安众硅、杭州芯匠签署《股权转让协议》，本次转让系执行回购。

2022年7月1日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	36.13%
2	淮堃创投	663.59	9.79%
3	临安众芯硅	370.02	5.46%
4	吴仁德	298.62	4.40%
5	临安众硅	289.00	4.26%
6	宁波领芯	265.44	3.91%
7	江苏中小基金	248.08	3.66%
8	嘉兴芯通	248.08	3.66%
9	宁波和丰	248.08	3.66%
10	杭州芯匠	211.00	3.11%
11	小满投资	165.39	2.44%
12	长兴青鸟	150.00	2.21%
13	临安创投	132.72	1.96%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
14	毅达太湖	124.04	1.83%
15	宁波毅达	124.04	1.83%
16	炬华联昕	119.45	1.76%
17	寓鑫创投	119.45	1.76%
18	朱力昂	116.13	1.71%
19	杭州众诚芯	100.00	1.47%
20	江苏聿泉	82.69	1.22%
21	浙江容腾	82.69	1.22%
22	好奇号	59.72	0.88%
23	苏州国发	41.35	0.61%
24	朗玛四十二号	41.35	0.61%
25	朱琳	30.00	0.44%
合 计		6,780.92	100.00%

（11）2022年10月，第七次增资

2022年8月14日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至7,460.92万元，新增注册资本680.00万元由宁容海川认缴。针对本次增资，标的公司现有股东均放弃优先认购权和反稀释权。

2022年8月25日，杭州众硅与宁容海川及相关方签署增资协议，约定宁容海川以680.00万元认购标的公司680.00万元注册资本。标的公司为引进拥有丰富行业经验的MICHAEL XIAOXUAN YANG先生，经全体股东一致同意，由MICHAEL XIAOXUAN YANG先生控制的企业宁容海川以1.00元/单位注册资本的价格向标的公司增资，并聘任MICHAEL XIAOXUAN YANG为标的公司董事长。

2022年10月31日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	32.84%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
2	宁容海川	680.00	9.11%
3	淮堃创投	663.59	8.89%
4	临安众芯硅	370.02	4.96%
5	吴仁德	298.62	4.00%
6	临安众硅	289.00	3.87%
7	宁波领芯	265.44	3.56%
8	江苏中小基金	248.08	3.33%
9	嘉兴芯通	248.08	3.33%
10	宁波和丰	248.08	3.33%
11	杭州芯匠	211.00	2.83%
12	小满投资	165.39	2.22%
13	长兴青鸟	150.00	2.01%
14	临安创投	132.72	1.78%
15	毅达太湖	124.04	1.66%
16	宁波毅达	124.04	1.66%
17	炬华联昕	119.45	1.60%
18	寓鑫创投	119.45	1.60%
19	朱力昂	116.13	1.56%
20	杭州众诚芯	100.00	1.34%
21	江苏聿泉	82.69	1.11%
22	浙江容腾	82.69	1.11%
23	好奇号	59.72	0.80%
24	苏州国发	41.35	0.55%
25	朗玛四十二号	41.35	0.55%
26	朱琳	30.00	0.40%
合 计		7,460.92	100.00%

（12）2022年12月，第八次增资、第四次股权转让

2022年11月6日，淮堃创投与南京星堃签订股权转让协议，约定淮堃创投将其所持标的公司248.14万元注册资本转让给南京星堃，转让

价格为 3,000.00 万元。

2022 年 11 月 20 日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意以下增资及股权转让事项：

（1）增资

标的公司注册资本增加至 7,800.05 万元，新增注册资本 339.13 万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
衢州瑞唐	4,000.00	271.31
海澳芯科	500.00	33.91
杰正投资	500.00	33.91
合计	5,000.00	339.13

（2）股权转让

淮堃创投将其所持标的公司 248.14 万元注册资本转让给南京星堃，转让价格为 3,000.00 万元。

2022 年 11 月 23 日，杭州众硅与海澳芯科、杰正投资及相关方签署增资协议，约定海澳芯科以 500.00 万元认购标的公司 33.91 万元注册资本；杰正投资以 500.00 万元认购标的公司 33.91 万元注册资本。

2022 年 11 月 25 日，杭州众硅与衢州瑞唐及相关方签署增资协议，约定衢州瑞唐以 4,000.00 万元认购标的公司 271.31 万元注册资本。

2022 年 12 月 7 日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	31.41%
2	宁容海川	680.00	8.72%
3	淮堃创投	415.46	5.33%
4	临安众芯硅	370.02	4.74%
5	吴仁德	298.62	3.83%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
6	临安众硅	289.00	3.71%
7	衢州瑞唐	271.31	3.48%
8	宁波领芯	265.44	3.40%
9	南京星堃	248.14	3.18%
10	江苏中小基金	248.08	3.18%
11	嘉兴芯通	248.08	3.18%
12	宁波和丰	248.08	3.18%
13	杭州芯匠	211.00	2.71%
14	小满投资	165.39	2.12%
15	长兴青鸟	150.00	1.92%
16	临安创投	132.72	1.70%
17	毅达太湖	124.04	1.59%
18	宁波毅达	124.04	1.59%
19	炬华联昕	119.45	1.53%
20	寓鑫创投	119.45	1.53%
21	朱力昂	116.13	1.49%
22	杭州众诚芯	100.00	1.28%
23	江苏赴泉	82.69	1.06%
24	浙江容腾	82.69	1.06%
25	好奇号	59.72	0.77%
26	苏州国发	41.35	0.53%
27	朗玛四十二号	41.35	0.53%
28	海澳芯科	33.91	0.43%
29	杰正投资	33.91	0.43%
30	朱琳	30.00	0.38%
合 计		7,800.05	100.00%

（13）2023年2月，第九次增资

2022年12月，杭州众硅分别与朗玛五十九号、朗玛六十号、朗玛六十三号、星成联芯、吴仁德、毅达鼎祺、嘉兴邦拓、朱力昂及相关方

签署增资协议，约定朗玛五十九号、朗玛六十号、朗玛六十三号、星成联芯、吴仁德、毅达鼎祺、嘉兴邦拓、朱力昂以 12,000.00 万元认购标的公司 624.00 万元注册资本。

2022 年 12 月 25 日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意标的公司注册资本增加至 8,424.05 万元，新增注册资本 624.00 万元由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
朗玛五十九号	1,500.00	78.00
朗玛六十号	1,500.00	78.00
朗玛六十三号	2,000.00	104.00
星成联芯	2,000.00	104.00
吴仁德	2,000.00	104.00
毅达鼎祺	1,500.00	78.00
嘉兴邦拓	1,000.00	52.00
朱力昂	500.00	26.00
合计	12,000.00	624.00

2023 年 2 月 17 日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	29.08%
2	宁容海川	680.00	8.07%
3	淮堃创投	415.46	4.93%
4	吴仁德	402.62	4.78%
5	临安众芯硅	370.02	4.39%
6	临安众硅	289.00	3.43%
7	衢州瑞唐	271.31	3.22%
8	宁波领芯	265.44	3.15%
9	南京星堃	248.14	2.95%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
10	江苏中小基金	248.08	2.94%
11	嘉兴芯通	248.08	2.94%
12	宁波和丰	248.08	2.94%
13	杭州芯匠	211.00	2.50%
14	小满投资	165.39	1.96%
15	长兴青鸟	150.00	1.78%
16	朱力昂	142.13	1.69%
17	临安创投	132.72	1.58%
18	毅达太湖	124.04	1.47%
19	宁波毅达	124.04	1.47%
20	炬华联昕	119.45	1.42%
21	寓鑫创投	119.45	1.42%
22	朗玛六十三号	104.00	1.23%
23	星成联芯	104.00	1.23%
24	杭州众诚芯	100.00	1.19%
25	江苏聿泉	82.69	0.98%
26	浙江容腾	82.69	0.98%
27	朗玛五十九号	78.00	0.93%
28	朗玛六十号	78.00	0.93%
29	毅达鼎祺	78.00	0.93%
30	好奇号	59.72	0.71%
31	嘉兴邦拓	52.00	0.62%
32	苏州国发	41.35	0.49%
33	朗玛四十二号	41.35	0.49%
34	海澳芯科	33.91	0.40%
35	杰正投资	33.91	0.40%
36	朱琳	30.00	0.36%
合 计		8,424.05	100.00%

（14）2023年6月，第十次增资、第五次股权转让

2023年4月25日,杭州众硅召开股东会并作出决议,同意以下增资及股权转让事项:

(1) 增资

标的公司注册资本增加至9,603.42万元,新增注册资本1,179.37万元由以下各增资方认缴:

增资方	增资金额(万元)	计入注册资本(万元)
杭州富浙	10,000.00	421.20
浙江富浙	10,000.00	421.20
宁波蓝郡	4,000.00	168.48
杭州北峰	2,000.00	84.24
温润贰号	1,975.00	83.19
温润叁号	25.00	1.05
合计	28,000.00	1,179.37

(2) 股权转让

转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
临安创投	杭州赋芯	109.0913	821.9700
	朱力昂	3.5190	26.5150
	淮堃创投	20.109	151.5150

2023年4月,杭州众硅分别与温润贰号、温润叁号、杭州富浙、宁波蓝郡、杭州北峰及相关方签署增资协议,约定温润贰号、温润叁号、杭州富浙、宁波蓝郡、杭州北峰以18,000.00万元认购标的公司758.17万元注册资本。

2023年5月30日,临安创投与杭州赋芯、朱力昂、淮堃创投签订《股权转让协议》,本次转让系执行回购。

2023年6月,杭州众硅分别与浙江富浙及相关方签署增资协议,约定浙江富浙以10,000.00万元认购标的公司421.20万元注册资本。

2023年6月27日,杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更

完成后,杭州众硅的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州众芯硅	2,449.98	25.51%
2	宁容海川	680.00	7.08%
3	淮堃创投	435.56	4.54%
4	杭州富浙	421.20	4.39%
5	浙江富浙	421.20	4.39%
6	吴仁德	402.62	4.19%
7	临安众芯硅	370.02	3.85%
8	临安众硅	289.00	3.01%
9	衢州瑞唐	271.31	2.83%
10	宁波领芯	265.44	2.76%
11	南京星堃	248.14	2.58%
12	江苏中小基金	248.08	2.58%
13	嘉兴芯通	248.08	2.58%
14	宁波和丰	248.08	2.58%
15	杭州芯匠	211.00	2.20%
16	宁波蓝郡	168.48	1.75%
17	小满投资	165.39	1.72%
18	长兴青鸟	150.00	1.56%
19	朱力昂	145.65	1.52%
20	毅达太湖	124.04	1.29%
21	宁波毅达	124.04	1.29%
22	炬华联昕	119.45	1.24%
23	寓鑫创投	119.45	1.24%
24	杭州赋芯	109.09	1.14%
25	朗玛六十三号	104.00	1.08%
26	星成联芯	104.00	1.08%
27	杭州众诚芯	100.00	1.04%
28	杭州北峰	84.24	0.88%
29	温润贰号	83.19	0.87%
30	江苏聿泉	82.69	0.86%
31	浙江容腾	82.69	0.86%
32	朗玛五十九号	78.00	0.81%

33	朗玛六十号	78.00	0.81%
34	毅达鼎祺	78.00	0.81%
35	好奇号	59.72	0.62%
36	嘉兴邦拓	52.00	0.54%
37	苏州国发	41.35	0.43%
38	朗玛四十二号	41.35	0.43%
39	海澳芯科	33.91	0.35%
40	杰正投资	33.91	0.35%
41	朱琳	30.00	0.31%
42	温润叁号	1.05	0.01%
合 计		9,603.42	100.00%

（15）2024年12月，第十一次增资、第六次股权转让

2024年11月28日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意以下增资及股权转让事项：

（1）增资

同意标的公司注册资本增加至 10,487.95 万元，新增注册资本 884.53 万元，由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
中微临港	2,000.00	84.24
台州金石投资	16,000.00	673.92
中信投资	2,000.00	84.24
石溪投资	1,000.00	42.12
合计	21,000.00	884.53

2）股权转让

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
杭州赋芯	中微临港	11.44	178.66
浙江容腾		82.69	1,291.64
海澳芯科		33.91	529.71
好奇号	石溪投资	59.72	932.85
杭州众芯硅		4.30	67.15

杭州赋芯	台州金石投资	97.65	1,525.29
杭州众芯硅		30.39	474.71
温润叁号	温润安享	1.05	25.00

本次股权转让价格对应标的公司的整体估值约为 16.38 亿元。

2024 年 12 月 31 日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	杭州众芯硅	2,415.29	23.03%
2	台州金石投资	801.97	7.65%
3	宁容海川	680.00	6.48%
4	淮堃创投	435.56	4.15%
5	杭州富浙	421.20	4.02%
6	浙江富浙	421.20	4.02%
7	吴仁德	402.62	3.84%
8	临安众芯硅	370.02	3.53%
9	临安众硅	289.00	2.76%
10	衢州瑞唐	271.31	2.59%
11	宁波领芯	265.44	2.53%
12	南京星堃	248.14	2.37%
13	江苏中小基金	248.08	2.37%
14	嘉兴芯通	248.08	2.37%
15	宁波和丰	248.08	2.37%
16	中微临港	212.29	2.02%
17	杭州芯匠	211.00	2.01%
18	宁波蓝郡	168.48	1.61%
19	小满投资	165.39	1.58%
20	长兴青鸟	150.00	1.43%
21	朱力昂	145.65	1.39%
22	毅达太湖	124.04	1.18%

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
23	宁波毅达	124.04	1.18%
24	炬华联昕	119.45	1.14%
25	寓鑫创投	119.45	1.14%
26	石溪投资	106.14	1.01%
27	朗玛六十三号	104.00	0.99%
28	星成联芯	104.00	0.99%
29	杭州众诚芯	100.00	0.95%
30	杭州北峰	84.24	0.80%
31	中信投资	84.24	0.80%
32	温润贰号	83.19	0.79%
33	江苏走泉	82.69	0.79%
34	朗玛五十九号	78.00	0.74%
35	朗玛六十号	78.00	0.74%
36	毅达鼎祺	78.00	0.74%
37	嘉兴邦拓	52.00	0.50%
38	苏州国发	41.35	0.39%
39	朗玛四十二号	41.35	0.39%
40	杰正投资	33.91	0.32%
41	朱琳	30.00	0.29%
42	温润安享	1.05	0.01%
合 计		10,487.9441	100.0000%

（16）2025年2月，第十二次增资、第七次股权转让

2024年12月31日，杭州众硅召开股东会并作出决议，同意以下增资及股权转让事项：

（1）增资

同意标的公司注册资本增加至 11,562.01 万元，新增注册资本 1,074.07 万元，由以下各增资方认缴：

增资方	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）
-----	----------	------------

江苏毅达	2,500.00	105.30
安徽丰禾	5,000.00	210.60
青岛东证	3,000.00	126.36
杭州达晨	5,250.00	221.13
深圳达晨	8,750.00	368.55
达晨财智	1,000.00	42.12
合计	25,500.00	1,074.07

2) 股权转让

因标的公司 2024 年 12 月增资及股权转让事宜触发反稀释条款。经各方协商一致，杭州众芯硅同意向 2023 年 6 月入股的投资人给予股权补偿，具体如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（元）
杭州众芯硅	杭州富浙	21.16	1.00
	浙江富浙	21.16	1.00
	宁波蓝郡	8.46	1.00
	杭州北峰	4.23	1.00
	温润贰号	4.18	1.00
	温润安享	0.05	1.00

2025 年 2 月 28 日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州众芯硅	2,356.04	20.38%
2	台州金石投资	801.97	6.94%
3	宁容海川	680.00	5.88%
4	杭州富浙	442.36	3.83%
5	浙江富浙	442.36	3.83%
6	淮堃创投	435.56	3.77%
7	吴仁德	402.62	3.48%
8	临安众芯硅	370.02	3.20%

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
9	深圳达晨	368.55	3.19%
10	临安众硅	289.00	2.50%
11	衢州瑞唐	271.31	2.35%
12	宁波领芯	265.44	2.30%
13	南京星堃	248.14	2.15%
14	江苏中小基金	248.08	2.15%
15	嘉兴芯通	248.08	2.15%
16	宁波和丰	248.08	2.15%
17	杭州达晨	221.13	1.91%
18	中微临港	212.29	1.84%
19	杭州芯匠	211.00	1.82%
20	安徽丰禾	210.60	1.82%
21	宁波蓝郡	176.95	1.53%
22	小满投资	165.39	1.43%
23	长兴青鸟	150.00	1.30%
24	朱力昂	145.65	1.26%
25	青岛东证	126.36	1.09%
26	毅达太湖	124.04	1.07%
27	宁波毅达	124.04	1.07%
28	炬华联昕	119.45	1.03%
29	寓鑫创投	119.45	1.03%
30	石溪投资	106.14	0.92%
31	江苏毅达	105.30	0.91%
32	朗玛六十三号	104.00	0.90%
33	星成联芯	104.00	0.90%
34	杭州众诚芯	100.00	0.86%
35	杭州北峰	88.47	0.77%
36	温润贰号	87.37	0.76%
37	中信投资	84.24	0.73%

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
38	江苏昶泉	82.69	0.72%
39	朗玛五十九号	78.00	0.67%
40	朗玛六十号	78.00	0.67%
41	毅达鼎祺	78.00	0.67%
42	嘉兴邦拓	52.00	0.45%
43	达晨财智	42.12	0.36%
44	苏州国发	41.35	0.36%
45	朗玛四十二号	41.35	0.36%
46	杰正投资	33.91	0.29%
47	朱琳	30.00	0.26%
48	温润安享	1.11	0.01%
合 计		11,562.01	100.00%

(17) 2025年8月，第八次股权转让

2025年8月11日，经杭州众硅股东会同意，以下各方分别签订股权转让协议，就股权转让事宜约定如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
衢州瑞唐	王敏文	135.99	2,005.00
	张久海	135.31	1,995.00
朱力昂	蔡刚波	55.16	1,100.00
宁波领芯		95.27	1,900.00
炬华联昕	扬州朗智	119.45	2,382.12
宁波和丰		248.08	4,947.48
苏州国发		41.35	824.58
淮堃创投		158.04	3,151.80
淮堃创投	中微临港	156.81	3,127.30
嘉兴芯通		248.08	4,947.48
寓鑫创投		119.45	2,382.12
吴仁德		402.62	8,029.37

南京星堃	国孚领航	248.14	4,948.61
宁波领芯		5.01	100.00
淮堃创投		120.71	2,407.32
星成联芯		104.00	2,074.07
朗玛四十二号		41.35	824.58
江苏中小基金		150.43	3,000.00
毅达太湖		75.21	1,500.00
宁波毅达		75.21	1,500.00

注 1：衢州瑞唐的主要合伙人为王敏文、张久海，本次转让中，衢州瑞唐将其所持标的公司股权按其初始投资成本转让给王敏文、张久海。

2025 年 9 月 10 日，杭州众硅完成本次变更的登记手续。本次变更完成后，杭州众硅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州众芯硅	2,356.04	20.38%
2	中微临港	1,392.40	12.04%
3	台州金石投资	801.97	6.94%
4	宁容海川	680.00	5.88%
5	扬州朗智	566.92	4.90%
6	国孚领航	566.92	4.90%
7	杭州富浙	442.36	3.83%
8	浙江富浙	442.36	3.83%
9	临安众芯硅	370.02	3.20%
10	深圳达晨	368.55	3.19%
11	临安众硅	289.00	2.50%
12	杭州达晨	221.13	1.91%
13	杭州芯匠	211.00	1.82%
14	安徽丰禾	210.60	1.82%
15	宁波蓝郡	176.95	1.53%
16	小满投资	165.39	1.43%

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
17	宁波领芯	165.15	1.43%
18	蔡刚波	150.43	1.30%
19	长兴青鸟	150.00	1.30%
20	王敏文	135.99	1.18%
21	张久海	135.31	1.17%
22	青岛东证	126.36	1.09%
23	石溪投资	106.14	0.92%
24	江苏毅达	105.30	0.91%
25	朗玛六十三号	104.00	0.90%
26	杭州众诚芯	100.00	0.86%
27	江苏中小基金	97.65	0.84%
28	朱力昂	90.49	0.78%
29	杭州北峰	88.47	0.77%
30	温润贰号	87.37	0.76%
31	中信投资	84.24	0.73%
32	江苏惠泉	82.69	0.72%
33	朗玛五十九号	78.00	0.67%
34	朗玛六十号	78.00	0.67%
35	毅达鼎祺	78.00	0.67%
36	嘉兴邦拓	52.00	0.45%
37	毅达太湖	48.83	0.42%
38	宁波毅达	48.83	0.42%
39	达晨财智	42.12	0.36%
40	杰正投资	33.91	0.29%
41	朱琳	30.00	0.26%
42	温润安享	1.11	0.01%
合 计		11,562.01	100.00%

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，杭州众硅电子科技有限公司股东及股权比例未发生变动。

3、资产、财务及经营状况

(1) 合并报表情况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日,公司资产总额 102,212.56 万元,负债总额为 26,932.17 万元,净资产 75,280.39 万元; 2025 年营业收入 24,411.88 万元,净利润-9,250.00 万元。公司近二年资产、财务状况如下表:

公司资产、负债及财务状况

金额单位:人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
总资产	90,728.47	102,212.56
负债	27,063.65	26,932.17
净资产	63,664.82	75,280.39
	2024 年度	2025 年度
营业收入	5,288.65	24,411.88
利润总额	-15,346.30	-9,250.00
净利润	-15,346.30	-9,250.00
审计机构	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

(2) 母公司报表情况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日,公司资产总额为 104,275.53 万元,负债总额为 26,755.27 万元,净资产为 77,520.26 万元; 2025 年营业收入 24,411.88 万元,净利润-8,531.79 万元。公司近二年资产、财务状况如下表:

公司资产、负债及财务状况

金额单位:人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
总资产	92,230.58	104,275.53
负债	26,852.48	26,755.27
净资产	65,378.09	77,520.26
	2024 年度	2025 年度
营业收入	5,288.65	24,411.88
利润总额	-14,426.64	-8,531.79
净利润	-14,426.64	-8,531.79
审计机构	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

4、经营情况介绍

杭州众硅主营业务为高端化学机械抛光和化学机械平坦化（CMP）设备的研发、生产及销售，并为客户提供 CMP 设备的整体解决方案。杭州众硅目前已推出多款自主创新研发的 12 英寸 CMP 设备，应用在晶圆制造、大硅片、先进封装及先进存储等领域，已发展成为半导体高端装备领域重要的厂商。

在晶圆制造抛光领域，目前国际主要设备供应商为应用材料、日本荏原。标的公司自主研发的 12 英寸化学机械平坦化设备（TTAIS®300 CMP）突破技术壁垒，已在国内主要先进存储和逻辑芯片制造厂商陆续进行认证并实现应用。该设备深度适配客户工艺需求，工艺覆盖金属、非金属等全品类抛光场景，可精准应用于先进逻辑、先进封装等核心制程环节，成为国内少数能为先进集成电路制造提供整套 CMP 设备技术方案的企业之一。标的公司自主创新研发的紧凑、高效 6 抛光盘设备平台设计，在单位设备产能、设备占地面积、设备性价比等核心大规模量产设备指标等方面表现突出，能有效降低客户设备综合运营成本。同时，其工艺适配性和灵活性可以匹配不同先进集成电路制造客户的工艺制程需求和不同工艺节点的工艺迭代/产能规划需求，减少工艺切换损耗，显著提升客户的生产效率和经济效益，助力客户提升在先进集成电路制造领域的竞争优势。

在大硅片抛光领域，对于 CMP 设备的金属和颗粒污染等工艺结果要求极高。目前全球大硅片衬底抛光 CMP 设备市场处于高度垄断状态，主要由冈本工作机械株式会社（即 Okamoto Machine Tool Works, Ltd）和应用材料两家国际设备制造商占据，设备国产化率低。标的公司针对大硅片抛光专门开发了 12 英寸硅片化学机械抛光设备（TTAIS®300 Si CMP）突破了高端硅片产品加工的技术瓶颈，同时实现了核心产品自主研发与制造。与同类产品相比，抛光平坦化和清洗效果均达到国际先进水平，能够适配先进制程工艺对高端硅片的要求。同时，单位设备产能、设备

占地面积、设备性价比等指标达到行业领先水平。

在第三代半导体碳化硅衬底抛光领域，标的公司以原创性技术研发并首创了碳化硅衬底用电化学机械抛光技术和设备（TNTAS®ECMP），解决了碳化硅抛光效率低、良率低、生产成本低及化学品对环境影响大等难题。与传统化学机械抛光和强氧化性抛光设备相比，具有去除率高、单片抛光综合运营成本低、工艺条件温和、晶片加工质量高、安全环保等优点，填补了量产型碳化硅衬底电化学机械抛光设备领域的空白，为碳化硅功率器件、射频器件等规模化应用提供了关键装备保障。

（1）主营产品

公司主要产品如下：

序号	产品类别	产品型号	产品特征/应用领域	产品图示
1	CMP装备	TTAIS®300 CMP	面向行业前沿需求开发的集先进平坦化工艺、高效率、高兼容性于一体的12英寸CMP装备。该装备采用6个独立研磨模组和2个独立清洗模组的全新紧凑架构，配置先进的终点检测技术与独特的耗材成本降低技术解决方式，具有高灵活性、高兼容性、低运营成本等特点，满足芯片制造的加工需求。主要应用于集成电路前道制造和先进封装。	
2	CMP装备	TTAIS®300 Si CMP	根据行业前沿应用技术需求开发的12英寸硅片CMP装备。该装备配备性能优越的硅片化学机械抛光和化学机械平坦化单元及清洗单元，卓越的工艺稳定性、高生产效率，可实现硅片表面的高平坦度和均匀性。主要应用于大硅片抛光。	
3	CMP装备	TNTAS®ECMP	针对快速增长的新兴市场需求开发的第三代半导体材料碳化硅专用CMP装备。该装备配备了独特的碳化硅衬底电化学机械抛光解决方案，集成先进的单片自动传输设备，具有高去除率、高产能、高效率等优点，满足第三代半导体材料工艺器件的技术需求。	

4	CMP 抛光 模组	DMS [®] 单 / 双 CMP 模组	该装备主要服务于研发机构及实验室场景，通过定制化研磨模组设计、先进终点控制技术、自动化工艺控制和整机通用设计，实现CMP工艺结果。	
5	研 磨 液 液 系 系 统 统	SDS [®]	根据市场需求开发的2个100升研磨液供液系统，该装备配备双重泵/过滤器式设计工艺，满足持续运行需求，适用制程包括Si/Poly/STI/ILD/W/Cu CMP等。	
6	研 磨 液 液 系 系 统 统	SDD [®]	根据市场需求开发的2个200升研磨液供液系统，该装备配备全自动系统，满足无杂质和颗粒污染需求，提供高效的系统数据监控与记录，适用制程包括Si/ Poly/ STI/ ILD/ W/ Cu CMP等。	

(2) 采购模式

标的公司的采购基于未来销售订单及主要销售产品的市场预期进行，采购部及生产计划部基于对未来销售的预期和供应链效率对公司生产所需的零部件进行备货，相关采购流程由生产计划部提请系统审核，并由采购部收到审核完成的请购单后进行下单。

CMP 设备是实现化学机械抛光和化学机械平坦化工艺的全自动超精密装备，零部件的精度、洁净度、稳定性、可靠性和一致性对于整机的工艺性能和质量产生较大影响。为保证标的公司产品的质量和性能，标的公司制定了严格的供应商准入和审核制度，根据供应商技术能力、质量管控能力、生产能力、价格水平、交货周期、资产管理和服务等因素，选定合格的供应商纳入合格供应商名录。标的公司一般会与主要供应商签订框架协议并以订单形式具体执行采购。对于新品研发中出现的新物料需求，若现有合格供应商无法供应，则启动新供应商及相应原材料的评估和验证，验证通过后进行采购。

（3）生产模式

标的公司主要根据客户订单或采购意向，并结合客户的差异化需求，进行定制化设计及生产制造，主要实行订单式生产和库存式生产相结合的生产管理方式。基于标的公司 CMP 设备采用模块化设计的优势，在客户有较明确采购预期时就可以开始安排产品的通用模块库存式生产，等待获得正式订单后再开始订单式生产，根据客户明确的技术参数和配置需求设计差异模块，生产剩余的通用模块（如有）和定制化方案中的差异模块。各个模块和功能单元由标的公司质量部门组织相关质量检测工作，全部满足要求后进行各单元和模块的整机组装工作，在过程中配置相应的软件系统，再进入下一环节。软件配置与系统测试是最终检验机台是否满足定制化需求的关键步骤，在全部测试完成后进行出货前质检及整机成品的包装出库。

（4）销售模式

标的公司主要以直销模式销售产品，通过与客户商业谈判或招投标的方式获取订单。

标的公司设有市场销售部负责市场竞争分析、销售预测与规划、市场开发和产品销售。标的公司设有设备工程部为客户提供驻场服务，设备工程部确保标的公司产品在客户生产环境中稳定、合规、高效地运行，最大化产品对客户价值，维护并深化客户关系，保障客户价值实现与满意度。具体包括负责标的公司产品在客户端的安装、调试、质保、维修、培训及服务等相关工作。

（5）研发模式

标的公司产品研发主要采取自主研发模式，建立了多部门协同配合的自主创新机制，研发中心（机械工程部、电气工程部、先进技术研发部、工艺工程部、工艺核心技术部、软件部）和技术工程部对新技术、新产品进行协同研发。新产品研发流程主要包括立项阶段、实施阶段和

测试验收阶段。

（6）盈利模式

杭州众硅主营业务为高端化学机械抛光和化学机械抛光平坦化（CMP）设备的研发、生产及销售，并为客户提供 CMP 设备的整体解决方案，即通过向下游集成电路制造商、碳化硅功率器件厂商等销售 CMP 装备、抛光模组配置方案及研磨液供液系统等产品，并提供关键耗材与维保、升级等服务来实现收入和利润。

（7）核心竞争力

1）聚焦半导体制造关键核心环节，核心技术自主可控

标的公司聚焦半导体制造关键核心环节，以技术研发创新为引擎，在 CMP 后清洗技术、终点检测控制技术、APC 智能控制技术、CMP 工艺应用等核心领域均实现创新突破并自主可控。如在终点检测控制技术上，开发了多样化多用途终点检测技术，包含了光谱终点检测系统，以及可融合的多频涡流终点检测系统和激光终点检测系统，适应不同材料不同膜厚检测需求，实现高精度实时反馈，确保抛光工艺的精准控制。其中白光终点检测技术，可在极短采集时间内对高转速抛光过程中大量白光光谱数据进行稳定且准确的实时提取。此外，标的公司已围绕核心技术构建起全方位知识产权保护矩阵，核心技术自主可控。

标的公司是国内少数能够自主创新制造 12 英寸 CMP 设备的企业，其设备采用 6 抛光盘的全新架构设计，突破了目前市场主流设备 4 盘或 3 盘的架构模式。6 抛光盘的设计不仅可同时支持 3 盘工艺或 2 盘工艺，更好匹配先进存储和逻辑芯片制造中多场景工艺需求，为逻辑芯片、存储芯片、功率器件等不同应用领域提供一站式解决方案，凸显“一机多用”的柔性生产优势。同时，产能方面实现了跨越式提升，结合模块化设计带来的快速维护能力，不仅降低了设备停机维护时间，更同步提升了运行稳定性与生产效率，为客户构建“高效低耗”的生产体系提供核

心支撑。该设备凭借技术创新性与产业化价值，已成功认定为“国内首台（套）装备”，这一认证印证了标的公司在 CMP 设备领域的技术领先地位，为半导体产业链高端装备国产化提供了关键支撑，具备广阔的市场空间。

2) 汇聚国内外高端人才，公司具备持续性创新能力

标的公司创始团队来自浙江大学、南京大学、美国哥伦比亚大学、美国密苏里大学罗拉分校、美国加州大学伯克利分校劳伦斯-伯克利国家实验室等国内外知名高校/科研院所，曾任职于应用材料、瓦里安半导体、屹唐半导体等知名企业。同时，标的公司组建了一支兼具国际视野与本土深耕能力的团队，团队核心成员行业经验丰富。此外，标的公司依托前瞻性的科研布局与创新生态，建立有浙江省博士后工作站、浙江省高新技术企业研究开发中心等科研创新平台，引进了来自国内外名校的硕士、博士人才，逐步形成“人才培养—技术攻关—成果转化”的全链条创新体系，具备持续创新能力。

3) 公司客户已覆盖业内知名企业，客户资源优质

集成电路制造企业和碳化硅功率器件厂商对各类半导体专业设备的技术标准和可靠性有着严苛的要求，对设备供应商的选择非常慎重，设备产品一旦验证通过并实际进入生产线，即进入客户的合格供应商名录，后续采购需求相对稳定。经过多年努力，标的公司自主研发并生产的 CMP 设备已成功进入国内知名先进存储厂商和逻辑芯片制造厂商，取得了良好的市场口碑，与客户建立了良好的合作关系。标的公司通过与业内知名企业的产品验证过程，对客户的核心需求、行业技术发展趋势理解更为深刻。

4) 设备核心模块自研实现自主可控

CMP 设备核心零部件长期以来被国外企业垄断，国内设备厂商依赖进口，面临供应中断、技术封锁等风险。标的公司已实现了诸如抛光头、

旋转接头、电推缸、风机过滤器等关键零部件的自主可控。通过零部件自研形成专利布局，构建技术壁垒，规避国外专利纠纷与技术封锁，摆脱对外部供应链的依赖，并形成了产业链上下游协同，为半导体装备产业链自主可控提供了关键支撑，强化了核心竞争力。同时，关键零部件的自研可降低零部件采购与维护成本，同时缩短设备交付与售后响应周期，推动国产 CMP 设备性价比优势凸显，助力国内晶圆厂降低生产成本，加速国产设备自主化发展进程。

（三）主要长期股权投资概述

截至本次评估基准日，杭州众硅电子科技有限公司长期股权投资 4 项，账面原值 5,010,521.88 元，计提减值准备 10,521.88 元，账面净值 5,000,000.00 元。具体如下：

序号	被投资单位名称	投资日期	持股比例	长期股权投资账面价值
1	众硅电子科技（上海）有限公司	2022/02	100%	5,000,000.00
2	SIZONE TECHNOLOGY(HK) LIMITED	2021/08	100%	-
3	众进芯科技（福建）有限公司	2023/12	99%	-
4	众恩芯科技（青岛）有限公司	2022/12	99%	-

注：截至本报告书出具日，众恩芯科技（青岛）有限公司、众进芯科技（福建）有限公司已变更为标的公司全资子公司。

1、众硅电子科技（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号

2 楼

法定代表人：HAIYANG GU

注册资本：500 万人民币

成立日期：2022 年 2 月 14 日

统一社会信用代码：91310000MA7GM08053

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；机械设备研发；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；机械设备销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（1）公司简介

众硅电子科技（上海）有限公司成立于 2022 年 2 月 14 日，公司注册资本为 500.00 万元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，众硅电子科技（上海）有限公司实收资本 500.00 万元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万元）	注册比例%	实收资本（万元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	500.00	100.00	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00	500.00	100.00

（2）资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，公司报表账面资产总额为 348.62 万元，负债为 2,078.80 万元，净资产-1,730.17 万元。截至评估基准日，实现营业收入 116.10 万元，净利润-717.90 万元。

2、众恩芯科技（青岛）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路 45 号东办公楼一楼 102 室 2026-0562（A）

法定代表人：朱琳

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2022 年 12 月 19 日

统一社会信用代码：91370220MAC6AK4762

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（1）公司简介

众恩芯科技（青岛）有限公司成立于2022年12月19日，公司注册资本为1,000.00万元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司和朱琳共同发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	990.00	99.00
2	朱琳	10.00	1.00
	合计	1,000.00	100.00

截至评估基准日2025年12月31日，众恩芯科技（青岛）有限公司实收资本0.00万元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万元）	注册比例%	实收资本（万元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	990.00	99.00	0.00	0.00
2	朱琳	10.00	1.00	0.00	0.00
	合计	1,000.00	100.00	0.00	0.00

（2）资产、财务及经营状况

截至评估基准日2025年12月31日，公司报表账面资产总额为0.07万元，负债为0.20万元，净资产为-0.13万元。截至评估基准日，实现营业收入0.00万元，净利润-0.03万元。

3、Sizone Technology (HK) Limited

公司类型：私人股份有限公司

公司地址：RM 1002, 10/F EASEY COMM, BLDG 253-261 HENNESSY RD, WAN CHAI, HONG KONG

成立日期：2021年8月4日

(1) 公司简介

Sizone Technology (HK) Limited 成立于 2021 年 8 月 4 日, 公司注册资本为 1.00 万港元, 系由股东杭州众硅电子科技有限公司发起设立。

公司成立时, 股权架构如下:

序号	股东名称	注册资本(万港元)	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	1.00	100.00
	合计	1.00	100.00

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日, Sizone Technology (HK) Limited 实收资本 1.00 万港元, 公司股权比例如下所示:

序号	股东	注册资本(万港元)	注册比例%	实收资本(万港元)	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	1.00	100.00	1.00	100.00
	合计	1.00	100.00	1.00	100.00

(2) 资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日, 公司报表账面资产总额为 0.00 万元, 负债为 0.00 万元, 净资产为 0.00 万元。截至评估基准日, 实现营业收入 0.00 万元, 净利润-0.62 万元。

4、众进芯科技(福建)有限公司

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司地址: 福建省晋江市福兴东路罗山段 3 号

法定代表人: 刘李

注册资本: 1,000 万人民币

成立日期: 2023 年 12 月 19 日

统一社会信用代码: 91350582MAD7GFQT8Q

经营范围: 一般项目: 技术推广服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械设备研发; 半导体器件专用设备制造; 半导体器件专用设备销售; 电子专用设备销售; 电子产品销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（1）公司简介

众进芯科技（福建）有限公司成立于 2023 年 12 月 19 日，公司注册资本为 1,000.00 万元，系由股东杭州众硅电子科技有限公司发起设立。

公司成立时，股权架构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	注册比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	100.00

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，众进芯科技（福建）有限公司实收资本 0.00 万元，公司股权比例如下所示：

序号	股东	注册资本（万元）	注册比例%	实收资本（万元）	实收资本占总注册资本比例%
1	杭州众硅电子科技有限公司	990.00	99.00	0.00	0.00
2	刘李	10.00	1.00	0.00	0.00
	合计	1,000.00	100.00	0.00	0.00

（2）资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，该公司尚未建账，资产总额为 0.00，净资产为 0.00。

（四）委托人与被评估单位之间的关系

本次资产评估的委托人为中微半导体设备（上海）股份有限公司，被评估单位为杭州众硅电子科技有限公司。委托人为被评估单位的股东及股权拟收购方。

（五）其他资产评估报告使用人

资产评估委托合同未约定其他报告使用人。

除国家法律法规另有规定外，任何未经评估机构和委托人确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者。

二、评估目的

根据《中微半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》，中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付

现金购买杭州众硅电子科技有限公司 64.69% 股权。为此，中微半导体设备（上海）股份有限公司需了解杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益于评估基准日 2025 年 12 月 31 日的市场价值。

本次资产评估的目的是反映杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值，为上述经济行为提供价值参考。

三、评估对象和评估范围

评估对象是杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益价值。评估范围为杭州众硅电子科技有限公司在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的全部资产及相关负债。

合并报表口径下，根据杭州众硅电子科技有限公司评估基准日审定后合并报表，合并报表口径下公司资产总额为 102,212.56 万元，负债总额为 26,932.17 万元，净资产为 75,280.39 万元。其中，流动资产 96,359.75 万元，非流动资产 5,852.82 万元；流动负债 25,714.73 万元，非流动负债 1,217.44 万元。

母公司报表口径下，根据杭州众硅电子科技有限公司评估基准日审定后单体报表，公司资产总额为 104,275.53 万元，负债总额为 26,755.27 万元，净资产为 77,520.26 万元。其中，流动资产 98,014.37 万元，非流动资产 6,261.16 万元；流动负债 25,537.84 万元，非流动负债 1,217.44 万元。

上述资产与负债数据摘自经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的被评估单位 2025 年 12 月 31 日标准无保留意见的《审计报告》（普华永道中天特审字(2026)第 0065 号），评估是在企业经过审计后的基础上进行的。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

（一）委估主要资产情况

本次评估范围中的主要资产为应收账款、存货、固定资产、无形资产等。其中，应收账款主要为应收下游客户设备销售货款；存货主要为生产 CMP 设备相关的原材料、委托加工物资、产成品、在产品、发出商品等；固定资产主要为经营用固定资产，包括车辆、机器设备及电子设备；无形资产主要为外购软件及账面未记录的专利权、软件著作权、商标、域名等。

（二）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

截至评估基准日，企业申报的账面记录的无形资产为 20 项外购软件，账面未记录的无形资产共 353 项。其中已注册中国境内商标共计 68 项，已注册中国境外商标共计 53 项，注册中的商标 3 项，软件著作权 8 项，已获批准的中国境内专利权 106 项，其中 42 项为发明专利、53 项为实用新型专利、11 项为外观设计专利，已获批准的中国境外专利权 114 项，其中 89 项为发明专利、23 项为外观设计专利、2 项为实用新型专利，域名 1 项，具体情况如下：

1、外购软件

序号	名称	取得日期	所有权人
1	中望 3D 软件	2025/08	杭州众硅电子科技有限公司
2	杭州北山科技有限公司中望 CAD 平台软件 5 套	2023/08	杭州众硅电子科技有限公司
3	中望 CAD 软件	2024/05	杭州众硅电子科技有限公司
4	中望 CAD 平台软件 V2020(5 套)	2023/10	杭州众硅电子科技有限公司
5	KeyShot11Pro	2023/10	杭州众硅电子科技有限公司
6	MATLAB	2022/12	杭州众硅电子科技有限公司
7	PLM 系统	2019/01	杭州众硅电子科技有限公司
8	ERP 系统	2019/09	杭州众硅电子科技有限公司
9	6400 网络安全系统一套	2021/09	杭州众硅电子科技有限公司

10	中望 3D 平台设计软件 V2020	2019/12	杭州众硅电子科技有限公司
11	中望 CAD 平台软件 V2020	2019/12	杭州众硅电子科技有限公司
12	中望 3D 平台设计软件 V2022	2021/07	杭州众硅电子科技有限公司
13	中望 3D 平台设计软件 V2023	2022/06	杭州众硅电子科技有限公司
14	中望 CAD2023 专业版	2022/08	杭州众硅电子科技有限公司
15	中望 3D2023 标准版升级	2022/09	杭州众硅电子科技有限公司
16	广州中望龙腾软件股份有限公司 杭州众硅 3D 产品功能开发费	2022/09	杭州众硅电子科技有限公司
17	中望 3D 平台设计软件 V2022（5 套）	2022/11	杭州众硅电子科技有限公司
18	COMSOL	2022/10	杭州众硅电子科技有限公司
19	MDK	2022/12	杭州众硅电子科技有限公司
20	KEIL	2022/12	杭州众硅电子科技有限公司

2、商标

境内商标明细如下：

序号	权利人	注册号	商标标识	专用权期限	使用类别
1	杭州众硅	83471595		2025-09-07 至 2035-09-06	7 类 机械设备
2	杭州众硅	80450440		2025-07-07 至 2035-07-06	9 类 科学仪器
3	杭州众硅	79453564		2025-03-28 至 2035-03-27	9 类 科学仪器
4	杭州众硅	78465551		2024-10-28 至 2034-10-27	9 类 科学仪器
5	杭州众硅	78465536		2024-10-28 至 2034-10-27	7 类 机械设备
6	杭州众硅	76918083		2024-08-28 至 2034-08-27	7 类 机械设备

7	杭州众硅	76541431	hCMP	2024-07-28 至 2034-07-27	7类 机械设备
8	杭州众硅	76532744	hCMP	2024-07-21 至 2034-07-20	9类 科学仪器
9	杭州众硅	76100178	mCMP	2024-07-14 至 2034-07-13	7类 机械设备
10	杭州众硅	76120133	mCMP	2024-07-14 至 2034-07-13	9类 科学仪器
11	杭州众硅	75675889	eView	2024-08-21 至 2034-08-20	9类 科学仪器
12	杭州众硅	75684558	sView	2024-06-07 至 2034-06-06	7类 机械设备
13	杭州众硅	75681896	eView	2024-08-21 至 2034-08-20	7类 机械设备
14	杭州众硅	75681934	sView	2025-06-14 至 2035-06-13	9类 科学仪器
15	杭州众硅	75374290	mMAP	2024-08-21 至 2034-08-20	7类 机械设备
16	杭州众硅	75354106	mMAP	2024-08-14 至 2034-08-13	9类 科学仪器
17	杭州众硅	75364792	eMAP	2024-06-07 至 2034-06-06	9类 科学仪器
18	杭州众硅	75354086	eMAP	2024-06-07 至 2034-06-06	7类 机械设备
19	杭州众硅	75285972A	CMP^e	2024-06-14 至 2034-06-13	7类 机械设备

20	杭州众硅	75285972	CMP^e	2025-06-21 至 2035-06-20	7类 机械设备
21	杭州众硅	74918117	eHEAD	2024-05-28 至 2034-05-27	7类 机械设备
22	杭州众硅	73335681	h-CMP	2024-02-07 至 2034-02-06	7类 机械设备
23	杭州众硅	73345937	h-CMP	2024-02-14 至 2034-02-13	9类 科学仪器
24	杭州众硅	73263142	preMAP	2024-04-07 至 2034-04-06	9类 科学仪器
25	杭州众硅	73266569	TTAI	2024-04-07 至 2034-04-06	7类 机械设备
26	杭州众硅	73247718	TTAI	2024-04-07 至 2034-04-06	9类 科学仪器
27	杭州众硅	73254489	preMAP	2024-04-07 至 2034-04-06	7类 机械设备
28	杭州众硅	71449178		2023-10-28 至 2033-10-27	3类 日化用品
29	杭州众硅	71453805	SIZONE	2024-02-28 至 2034-02-27	9类 科学仪器
30	杭州众硅	71324724	SIZONE	2024-12-07 至 2034-12-06	42类 设计研究
31	杭州众硅	71046046	wCMP	2024-04-21 至 2034-04-20	9类 科学仪器
32	杭州众硅	71043369	tCMP	2023-10-21 至 2033-10-20	7类 机械设备

33	杭州众硅	71054635	tCMP	2023-10-07 至 2033-10-06	9 类 科学仪器
34	杭州众硅	71040472	wCMP	2023-10-07 至 2033-10-06	7 类 机械设备
35	杭州众硅	69985134	CMP^e	24-01-21 至 2034-01-20	9 类 科学仪器
36	杭州众硅	69474158	ZHONG GUI	2024-03-21 至 2034-03-20	7 类 机械设备
37	杭州众硅	69130284	 SIZONE	2023-09-21 至 2033-09-20	7 类 机械设备
38	杭州众硅	69135169	TTAIS	2023-09-21 至 2033-09-20	9 类 科学仪器
39	杭州众硅	69134470	 SIZONE	2023-09-21 至 2033-09-20	40 类 材料加工
40	杭州众硅	69120026	 SIZONE	2023-10-07 至 2033-10-06	1 类 化学原料
41	杭州众硅	69120069	 SIZONE	2023-09-14 至 2033-09-13	37 类 建筑修理
42	杭州众硅	69136420	TTAIS	2023-09-07 至 2033-09-06	7 类 机械设备
43	杭州众硅	69129658	 SIZONE	2024-11-28 至 2034-11-27	42 类 设计研究
44	杭州众硅	67125479	sCMP	2023-04-14 至 2033-04-13	7 类 机械设备
45	杭州众硅	67129953	sCMP	2023-04-14 至 2033-04-13	9 类 科学仪器

46	杭州众硅	67116815	xCMP	2023-04-14 至 2033-04-13	7类 机械设备
47	杭州众硅	65713545	TNTAS	2023-01-21 至 2033-01-20	9类 科学仪器
48	杭州众硅	65715828	TTAIS	2024-04-14 至 2034-04-13	7类 机械设备
49	杭州众硅	65720217	TMTAS	2023-01-14 至 2033-01-13	7类 机械设备
50	杭州众硅	65734434	TNTAS	2023-01-14 至 2033-01-13	7类 机械设备
51	杭州众硅	65713519	TTAISN	2023-01-14 至 2033-01-13	9类 科学仪器
52	杭州众硅	65718889	TMTAS	2023-01-14 至 2033-01-13	9类 科学仪器
53	杭州众硅	65738714	TTAIS	2023-03-21 至 2033-03-20	9类 科学仪器
54	杭州众硅	65738637	TTAISN	2023-01-14 至 2033-01-13	7类 机械设备
55	杭州众硅	65715828A	TTAIS	2023-02-28 至 2033-02-27	7类 机械设备
56	杭州众硅	65341636	SIZONE NSD	2022-12-07 至 2032-12-06	9类 科学仪器
57	杭州众硅	65352408	SIZONE SDD	2022-12-07 至 2032-12-06	7类 机械设备
58	杭州众硅	65344838	SIZONE SDS	2022-11-28 至 2032-11-27	7类 机械设备

59	杭州众硅	65344892	SIZONE DMS	2022-12-07 至 2032-12-06	9 类 科学仪器
60	杭州众硅	65352855	SIZONE DMS	2022-12-07 至 2032-12-06	7 类 机械设备
61	杭州众硅	65352699	SIZONE SDD	2022-12-07 至 2032-12-06	9 类 科学仪器
62	杭州众硅	65337973	SIZONE NSD	2022-12-07 至 2032-12-06	7 类 机械设备
63	杭州众硅	65352697	SIZONE SDS	2022-12-07 至 2032-12-06	9 类 科学仪器
64	杭州众硅	34700114	Tenms	2019-07-07 至 2029-07-06	9 类 科学仪器
65	杭州众硅	34700098	Tenms	2019-07-07 至 2029-07-06	7 类 机械设备
66	杭州众硅	32274636		2019-04-07 至 2029-04-06	9 类 科学仪器
67	杭州众硅	32274633		2019-12-21 至 2029-12-20	7 类 机械设备
68	杭州众硅	32279159		2020-04-21 至 2030-04-20	9 类 科学仪器

境外商标明细如下:

序号	商标名称	国家/地区/组织	注册地	注册号	类别	注册日	有效期	权利人	取得方式	他项权利
1		马德里国际注册	日本	1532374	7 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
2			日本	1531846	9 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
3			韩国	1532374	7 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
4			韩国	1531846	9 类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无

5			美国	6297605	7类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
6			美国	6291605	9类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
7			欧盟	1532374	7类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
8			欧盟	1531846	9类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
9			新加坡	1532374	7类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
10			新加坡	1531846	9类	2020-04-27	2030-04-27	杭州众硅	原始取得	无
11		中国台湾	中国台湾	02109945	7类、9类	2020-12-16	2030-12-15	杭州众硅	原始取得	无
12		马德里国际注册	日本	1548407	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
13		日本	日本	6387275	9类	2021-05-11	2031-05-11	杭州众硅	原始取得	无
14		马德里国际注册	韩国	1548407	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
15		韩国	韩国	40-1752832	9类	2021-07-15	2031-07-15	杭州众硅	原始取得	无
16		马德里国际注册	美国	6268972	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
17		美国	美国	6444084	9类	2021-08-10	2031-08-10	杭州众硅	原始取得	无
18		马德里国际注册	欧盟	1548407	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
19		欧盟	欧盟	018224343	9类	2020-08-01	2030-04-10	杭州众硅	原始取得	无
20		马德里国际注册	新加坡	1548407	7类	2020-04-22	2030-04-22	杭州众硅	原始取得	无
21		新加坡	新加坡	40202009597U	9类	2020-05-08	2030-05-08	杭州众硅	原始取得	无
22		中国台湾	中国台湾	02099392	7类、9类	2020-11-01	2030-10-31	杭州众硅	原始取得	无
23		欧盟	欧盟	018823748	7类、9类	2023-06-14	2033-01-19	杭州众硅	原始取得	无
24		韩国	韩国	40-2270814	7类	2024-11-08	2034-11-08	杭州众硅	原始取得	无
25		韩国	韩国	40-2270830	9类	2024-11-04	2034-11-04	杭州众硅	原始取得	无

26		日本	日本	6717320	7类、9类	2023-07-13	2033-07-13	杭州众硅	原始取得	无
27		新加坡	新加坡	40202302136W	7类、9类	2023-02-07	2033-02-07	杭州众硅	原始取得	无
28		中国台湾	中国台湾	02316528	7类	2023-09-01	2033-08-31	杭州众硅	原始取得	无
29		中国台湾	中国台湾	02316740	9类	2023-09-01	2033-08-31	杭州众硅	原始取得	无
30		美国	美国	7666240	7类、9类	2025-01-28	2035-01-29	杭州众硅	原始取得	无
31	TNTAS	欧盟	欧盟	018865670	7类、9类	2023-09-12	2033-04-21	杭州众硅	原始取得	无
32		日本	日本	6747127	7类、9类	2023-10-20	2033-10-20	杭州众硅	原始取得	无
33		中国台湾	中国台湾	02334452	7类	2023-11-16	2033-11-15	杭州众硅	原始取得	无
34		中国台湾	中国台湾	02334712	9类	2023-11-16	2033-11-15	杭州众硅	原始取得	无
35		新加坡	新加坡	40202309676Y	7类、9类	2024-03-13	2033-05-04	杭州众硅	原始取得	无
36		美国	美国	7432079	7类、9类	2024-07-02	2034-07-03	杭州众硅	原始取得	无
37		韩国	韩国	40-2283338	7类	2024-12-02	2034-12-01	杭州众硅	原始取得	无
38		韩国	韩国	40-2283341	9类	2024-12-02	2034-12-01	杭州众硅	原始取得	无
39	mCMP	新加坡	新加坡	40202501796W	7类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
40		中国台湾	中国台湾	02484328	7类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
41	tCMP	新加坡	新加坡	40202501797R	7类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
42		中国台湾	中国台湾	02484327	7类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
43	xCMP	新加坡	新加坡	40202501798P	7类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
44		中国台湾	中国台湾	02484326	7类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
45	dView	新加坡	新加坡	40202501793X	9类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
46		中国台湾	中国台湾	02474470	9类	2025-08-16	2035-08-15	杭州众硅	原始取得	无
47	eView	新加坡	新加坡	40202501792S	9类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无

48		中国台湾	中国台湾	02484467	9类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
49	sView	新加坡	新加坡	40202501794V	9类	2025-01-23	2035-01-23	杭州众硅	原始取得	无
50		中国台湾	中国台湾	02484466	9类	2025-10-01	2035-09-30	杭州众硅	原始取得	无
51	mCMP	美国	美国	7982584	7类	2025-10-14	2035-10-14	杭州众硅	原始取得	无
52	tCMP	美国	美国	7982583	7类	2025-10-14	2035-10-14	杭州众硅	原始取得	无
53	xCMP	美国	美国	7982582	7类	2025-10-14	2035-10-14	杭州众硅	原始取得	无

注册中的商标明细如下：

序号	内容或名称	取得日期	专利号或注册号
1		2025/02	78483204
2		2025/02	83718856
3		2025/02	83708238

3、软件著作权

序号	权利人	软件名称	证书编号	登记号	取得方式	首次发表日	他项权利
1	杭州众硅	Sizone Canaan CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第3979698号	2019SR0558941	原始取得	未发表	无
2	杭州众硅	Sizone SINAI CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第6652088号	2020SR1849086	原始取得	未发表	无
3	杭州众硅	Sizone ZION CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第7676983号	2021SR0954357	原始取得	未发表	无
4	杭州众硅	Sizone DRACO CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第9688894号	2022SR0734695	原始取得	未发表	无
5	杭州众硅	SDS 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第9639224号	2022SR0685025	原始取得	未发表	无
6	杭州众硅	Sizone SHEBA CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第11645217号	2023SR1058044	原始取得	未发表	无
7	杭州众硅	Sizone LAMB CMP 系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第11646342号	2023SR1059169	原始取得	未发表	无
8	杭州众硅	Sizone Dove 第三代半导体系统自动化控制软件 V1.0	软著登字第12283993号	2023SR1696820	原始取得	未发表	无

4、专利

中国境内专利权明细如下：

序号	权利人	专利名称	专利号	申请日	专利类型	取得途径	法律状态	他项权利
1	杭州众硅	一种化学机械抛光的在线监测装置	2023112396583	2023-09-22	发明	原始取得	授权	无
2	杭州众硅	一种抛光垫沟槽在线修整方法及装置	2025112141085	2025-08-28	发明	原始取得	授权	无
3	杭州众硅	一种用于晶圆清洗装置的从动机构及晶圆清洗装置	2025113685359	2025-09-24	发明	原始取得	授权	无
4	杭州众硅	一种化学机械抛光在线监测方法	2025110653799	2025-07-31	发明	原始取得	授权	无
5	杭州众硅	一种用于CMP设备抛光垫沟槽修整的方法	2023112936007	2023-10-08	发明	原始取得	授权	无
6	杭州众硅	站立式晶圆卡座	202111533401X	2021-12-15	发明	原始取得	授权	无
7	杭州众硅	一种可调平式抛光盘及抛光系统	2024223742429	2024-09-27	实用新型	原始取得	授权	无
8	杭州众硅	一种晶圆提拉结构	2025103110213	2025-03-17	发明	原始取得	授权	无
9	杭州众硅	一种用于快速调温的化学液输送单元及化学机械平坦化设备	2024206596934	2024-04-01	实用新型	原始取得	授权	无
10	杭州众硅	抛光研磨装置	2024304771328	2024-07-30	外观设计	原始取得	授权	无
11	杭州众硅	一种电化学机械抛光及平坦化装置	2024211355783	2024-05-23	实用新型	原始取得	授权	无
12	杭州众硅	一种用于半导体湿法设备的晶圆定位检测方法	2024116930911	2024-11-25	发明	原始取得	授权	无
13	杭州众硅	一种用于电化学机械平坦化设备的电抛光头、导电系统及其装配方法	2025101877875	2025-02-20	发明	原始取得	授权	无
14	杭州众硅	联动式单动力源控制间停机构、晶圆修整机构及工作方法	2024116669404	2024-11-21	发明	原始取得	授权	无
15	杭州众硅	一种晶圆搬运装置及抛光系统、抛光工艺	2024116612270	2024-11-20	发明	原始取得	授权	无
16	杭州众硅	一种抛光垫及晶圆抛光系统	2024203287163	2024-02-22	实用新型	原始取得	授权	无
17	杭州众硅	一种化学机械抛光及平坦化系统	2024204236775	2024-03-05	实用新型	原始取得	授权	无
18	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2024202256223	2024-01-30	实用新型	原始取得	授权	无
19	杭州众硅	一种用于导电晶圆的传输装置	2024208760026	2024-04-25	实用新型	原始取得	授权	无
20	杭州众硅	一种带有压力检测的修整装置	2024210918589	2024-05-17	实用新型	原始取得	授权	无
21	杭州众硅	一种晶圆旋转干燥装置	2024206000894	2024-03-26	实用新型	原始取得	授权	无
22	杭州众硅	化学机械平坦化装置	2024301324801	2024-03-15	外观设计	原始取得	授权	无
23	杭州	抛光研磨装置	20243004	2024-0	外观	原始	授权	无

	众硅		60724	1-24	设计	取得		
24	杭州众硅	一种导电型晶圆化学机械抛光系统	2023233277503	2023-12-05	实用新型	原始取得	授权	无
25	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备和晶圆传输方法	2019104814482	2019-06-04	发明	原始取得	授权	无
26	杭州众硅	一种化学机械抛光的在线监测装置	2023226009702	2023-09-22	实用新型	原始取得	授权	无
27	杭州众硅	一种化学机械抛光设备及其晶圆缓存装置和晶圆缓存方法	2021104070747	2021-04-15	发明	原始取得	授权	无
28	杭州众硅	一种晶圆传输机械手	2021102933431	2019-09-06	发明	原始取得	授权	无
29	杭州众硅	晶圆夹持臂夹爪	2022305192323	2022-08-10	外观设计	原始取得	授权	无
30	杭州众硅	一种可隔离防护晶圆的晶圆处理装置	2020113382226	2020-11-25	发明	原始取得	授权	无
31	杭州众硅	晶圆抛光系统	2023218495446	2023-07-13	实用新型	原始取得	授权	无
32	杭州众硅	一种晶圆传输装置	2023216687244	2023-06-28	实用新型	原始取得	授权	无
33	杭州众硅	一种晶圆传输监测系统	2023218599746	2023-07-13	实用新型	原始取得	授权	无
34	杭州众硅	一种预清洗输入装置	2023216754959	2023-06-28	实用新型	原始取得	授权	无
35	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备	2023216722892	2023-06-28	实用新型	原始取得	授权	无
36	杭州众硅	一种 CMP 抛光垫再加工装置	2023216039222	2023-06-21	实用新型	原始取得	授权	无
37	杭州众硅	一种用于半导体清洗单元的晶圆有无检测装置	2023208720594	2023-04-14	实用新型	原始取得	授权	无
38	杭州众硅	一种拼接式工作台机构	2023209035886	2023-04-20	实用新型	原始取得	授权	无
39	杭州众硅	一种晶圆清洁干燥模组状态检测方法、装置及平坦化设备	2022105084239	2022-05-11	发明	原始取得	授权	无
40	杭州众硅	一种晶圆清洗干燥装置	2023203161480	2023-02-14	实用新型	原始取得	授权	无
41	杭州众硅	一种抛光垫加工装置	2022229899063	2022-11-07	实用新型	原始取得	授权	无
42	杭州众硅	一种晶圆清洗箱	2023201723676	2023-01-13	实用新型	原始取得	授权	无
43	杭州众硅	一种排风脏污收集装置及化学机械平坦化抛光设备	2023208367028	2023-04-14	实用新型	原始取得	授权	无
44	杭州众硅	一种处理导电型晶圆衬底的电化学机械抛光及平坦化设备	2022229651320	2022-11-03	实用新型	原始取得	授权	无
45	杭州众硅	应用于导电型晶圆衬底的电化学机械抛光及平坦化设备	2022229771233	2022-11-03	实用新型	原始取得	授权	无
46	杭州	一种用于 CMP 设备的电化	20222296	2022-1	实用	原始	授权	无

	众硅	学机械抛光及平坦化系统	14336	1-03	新型	取得		
47	杭州众硅	一种晶圆干燥装置	20232054 56301	2023-0 3-14	实用 新型	原始 取得	授权	无
48	杭州众硅	一种用于化学机械平坦化白光终点检测的采集方法及系统	20221060 70657	2022-0 5-31	发明	原始 取得	授权	无
49	杭州众硅	一种导电型抛光头固定装置及导电型抛光头系统	20222312 54625	2022-1 1-23	实用 新型	原始 取得	授权	无
50	杭州众硅	一种化学机械抛光的在线监测装置	20232016 37007	2023-0 1-13	实用 新型	原始 取得	授权	无
51	杭州众硅	晶圆夹持器	20223051 91918	2022-0 8-10	外观 设计	原始 取得	授权	无
52	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	20222348 91659	2022-1 2-22	实用 新型	原始 取得	授权	无
53	杭州众硅	一种晶圆干燥抬升方法	20231024 18938	2023-0 3-14	发明	原始 取得	授权	无
54	杭州众硅	一种晶圆有无检测的提拉结构机械手	20222285 46755	2022-1 0-26	实用 新型	原始 取得	授权	无
55	杭州众硅	一种晶圆抛光系统、装载方法及其使用方法	20221031 61527	2022-0 3-29	发明	原始 取得	授权	无
56	杭州众硅	一种清洗刷预清洗系统	20201015 73307	2020-0 3-09	发明	原始 取得	授权	无
57	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	20221126 94450	2022-1 0-18	发明	原始 取得	授权	无
58	杭州众硅	抛光研磨装置（150&300）	20223040 99308	2022-0 6-30	外观 设计	原始 取得	授权	无
59	杭州众硅	一种涡流终点检测装置及方法	20221125 74529	2022-1 0-14	发明	原始 取得	授权	无
60	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备	20222212 8694X	2022-0 8-12	实用 新型	原始 取得	授权	无
61	杭州众硅	一种晶圆循环清洗系统	20222210 15365	2022-0 8-10	实用 新型	原始 取得	授权	无
62	杭州众硅	一种晶圆夹持装置	20222209 57792	2022-0 8-10	实用 新型	原始 取得	授权	无
63	杭州众硅	抛光研磨装置（300β）	20223041 03360	2022-0 6-30	外观 设计	原始 取得	授权	无
64	杭州众硅	抛光研磨装置（200s）	20223040 96846	2022-0 6-30	外观 设计	原始 取得	授权	无
65	杭州众硅	一种晶圆旋转机构、晶圆旋转夹持机构及晶圆清洗干燥系统	20221073 27358	2022-0 6-27	发明	原始 取得	授权	无
66	杭州众硅	一种晶圆搬运装置	20222141 28871	2022-0 6-07	实用 新型	原始 取得	授权	无
67	杭州众硅	供液装置	20223051 64982	2022-0 8-09	外观 设计	原始 取得	授权	无
68	杭州众硅	清洗装置	20223050 55190	2022-0 8-04	外观 设计	原始 取得	授权	无
69	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	20222165 87824	2022-0 6-30	实用 新型	原始 取得	授权	无

70	杭州众硅	一种晶圆传递装置	2022207093191	2022-03-29	实用新型	原始取得	授权	无
71	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	2021114452396	2021-11-30	发明	原始取得	授权	无
72	杭州众硅	一种标定抛光头和装卸台工作位置的装置	2022209517117	2022-04-24	实用新型	原始取得	授权	无
73	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备	2021230946535	2021-12-10	实用新型	原始取得	授权	无
74	杭州众硅	一种提拉式晶圆传输机构	2022202326195	2022-01-26	实用新型	原始取得	授权	无
75	杭州众硅	一种晶圆检测系统	2022203603706	2022-02-22	实用新型	原始取得	授权	无
76	杭州众硅	晶圆抛光系统	2021229713411	2021-11-30	实用新型	原始取得	授权	无
77	杭州众硅	一种动态检测装置及化学机械平坦化设备	2022101643690	2022-02-23	发明	原始取得	授权	无
78	杭州众硅	晶圆驱动机构	2021230426920	2021-12-06	实用新型	原始取得	授权	无
79	杭州众硅	一种站立式晶圆卡座	2021231583806	2021-12-15	实用新型	原始取得	授权	无
80	杭州众硅	一种抛光垫修整装置	2022100041307	2022-01-05	发明	原始取得	授权	无
81	杭州众硅	一种抛光垫表面状况在线检测方法及检测系统	2022100773979	2022-01-24	发明	原始取得	授权	无
82	杭州众硅	晶圆抛光系统	2021229694980	2021-11-30	实用新型	原始取得	授权	无
83	杭州众硅	一种晶圆抛光装置	2021112182640	2021-10-20	发明	原始取得	授权	无
84	杭州众硅	一种用于晶圆的寻位装置、寻位方法及晶圆计速方法	2021114722319	2021-12-06	发明	原始取得	授权	无
85	杭州众硅	一种晶圆紧固装置	2021216969237	2021-07-23	实用新型	原始取得	授权	无
86	杭州众硅	用于清洗晶圆的排列式兆声清洗装置	2021225192769	2021-10-19	实用新型	原始取得	授权	无
87	杭州众硅	一种用于晶圆的紧固装置	2021216969256	2021-07-23	实用新型	原始取得	授权	无
88	杭州众硅	多晶圆刷洗装置	2021225191535	2021-10-19	实用新型	原始取得	授权	无
89	杭州众硅	晶圆紧固装置	2021216940328	2021-07-23	实用新型	原始取得	授权	无
90	杭州众硅	抛光装置	2021304973519	2021-08-03	外观设计	原始取得	授权	无
91	杭州众硅	一种晶圆清洗干燥方法及机构	2021108994674	2021-08-06	发明	原始取得	授权	无
92	杭州众硅	一种多工位夹取装置	202110770071X	2021-07-08	发明	原始取得	授权	无
93	杭州众硅	一种晶圆装载支架、晶圆装载系统及晶圆装片方法	2019104403343	2019-05-24	发明	原始取得	授权	无
94	杭州众硅	一种结合研磨和单晶圆清洗模组的化学机械平坦化	2019111130957	2019-11-14	发明	原始取得	授权	无

		设备						
95	杭州众硅	一种抛光装置	202011419911X	2020-12-08	发明	原始取得	授权	无
96	杭州众硅	用于化学机械平坦化设备的抛光头压力控制设备及方法	2019113033010	2019-12-17	发明	原始取得	授权	无
97	杭州众硅	抛光头检测装置、腔室气密性和传感器有效性检测方法	2021104488565	2021-04-25	发明	原始取得	授权	无
98	杭州众硅	一种用于 CMP 清洗单元搬运晶圆的机械手及方法	2021102490467	2021-03-08	发明	原始取得	授权	无
99	杭州众硅	一种晶圆位置检测装置	2021102490255	2021-03-08	发明	原始取得	授权	无
100	杭州众硅	一种晶圆传输机械手及其晶圆翻转方法	2019108427084	2019-09-06	发明	原始取得	授权	无
101	杭州众硅	一种晶圆传输设备、化学机械平坦化装置及晶圆传输方法	2020107204397	2020-07-24	发明	原始取得	授权	无
102	杭州众硅	一种晶圆清洗干燥装置	2020102077484	2020-03-23	发明	原始取得	授权	无
103	杭州众硅	基于光谱的化学机械抛光在线终点检测方法	2019104403451	2019-05-24	发明	原始取得	授权	无
104	杭州众硅	一种化学机械抛光平坦化晶圆传输设备	2019208326110	2019-06-04	实用新型	原始取得	授权	无
105	杭州众硅	一种晶圆清洗装置	2019209736837	2019-06-26	实用新型	原始取得	授权	无
106	杭州众硅	内置式双重限位机构	2019202198142	2019-02-21	实用新型	原始取得	授权	无

中国境外专利权明细如下：

序号	权利人	专利名称	国家/地区/组织	专利号	申请日	授权日	专利类型	取得方式	他项权利
1	杭州众硅	一种抛光装卸部件模块	美国	US 12,194,592 B2	2021-03-22	2025-01-14	发明	原始取得	无
2	杭州众硅		新加坡	11202102935Q	2019-08-28	2025-08-12	发明	原始取得	无
3	杭州众硅		韩国	10-2584030	2021-04-19	2023-09-25	发明	原始取得	无
4	杭州众硅	用于 CMP 工艺的晶片装载支架、晶片装载系统和晶片安装方法	美国	US 12,103,134 B2	2019-09-04	2024-10-01	发明	原始取得	无
5	杭州众硅		新加坡	11202111470X	2019-09-04	2025-01-27	发明	原始取得	无
6	杭州众硅		韩国	10-2605197	2021-09-13	2023-11-20	发明	原始取得	无

7	杭州众硅	一种化学机械平坦化设备和晶圆传输方法、晶圆平坦化单元	美国	US 12,251,785 B2	2019-0 8-20	2025-0 3-18	发明	原始取得	无
8	杭州众硅	化学机械平坦化设备及晶圆转移方法、晶圆平坦化装置	韩国	10-2533567	2021-0 4-07	2023-0 5-12	发明	原始取得	无
9	杭州众硅		新加坡	1120210347 7T	2019-0 8-20	2023-0 9-19	发明	原始取得	无
10	杭州众硅	晶圆检测装置及使用该装置的晶圆检测方法	美国	US 11,961,749 B2	2020-0 8-04	2024-0 4-16	发明	原始取得	无
11	杭州众硅	CMP 晶圆清洗设备、晶圆传送机器人及晶圆翻转方法	韩国	10-2709839	2021-0 4-27	2024-0 9-20	发明	原始取得	无
12	杭州众硅		新加坡	1120210385 2Y	2019-0 9-26	2024-0 2-08	发明	原始取得	无
13	杭州众硅		美国	US 11,908,720 B2	2021-0 4-09	2024-0 2-20	发明	原始取得	无
14	杭州众硅	晶圆清洗干燥装置	美国	US 12,482,674 B2	2020-0 9-29	2025-1 1-25	发明	原始取得	无
15	杭州众硅		韩国	10-2705137	2022-0 6-20	2024-0 9-05	发明	原始取得	无
16	杭州众硅	晶圆输送装置、化学机械平坦化装置及晶圆输送方法	美国	US 12,427,619 B2	2020-0 8-06	2025-0 9-30	发明	原始取得	无
17	杭州众硅	晶圆位置检测装置	日本	7638389	2021-1 0-20	2025-0 2-20	发明	原始取得	无
18	杭州众硅		韩国	10-2858973	2023-0 9-08	2025-0 9-09	发明	原始取得	无
19	杭州众硅	一种标定抛光头和装卸台工作位置的装置和方法	日本	7714253	2022-1 0-14	2025-0 7-18	发明	原始取得	无
20	杭州众硅	晶圆抛光系统	韩国	10-2837898	2024-0 2-14	2025-0 7-21	发明	原始取得	无

21	杭州众硅		日本	7712007	2022-08-30	2025-07-14	发明	原始取得	无
22	杭州众硅	晶圆抛光装置	美国	US 11,794,304 B2	2022-01-19	2023-10-24	发明	原始取得	无
23	杭州众硅		韩国	10-2693838	2022-02-24	2024-08-06	发明	原始取得	无
24	杭州众硅		新加坡	1020220157 1V	2022-02-18	2024-08-21	发明	原始取得	无
25	杭州众硅	晶圆抛光系统	日本	7728045	2022-08-30	2025-08-14	发明	原始取得	无
26	杭州众硅		韩国	10-2837898	2024-02-14	2025-07-21	发明	原始取得	无
27	杭州众硅	抛光研磨装置	美国	US D1,018,612 S	2022-10-19	2024-03-19	外观设计	原始取得	无
28	杭州众硅		韩国	DM/226149	2022-10-19	2023-11-28	外观设计	原始取得	无
29	杭州众硅		新加坡	DM/226149	2022-10-19	2022-10-19	外观设计	原始取得	无
30	杭州众硅		日本	1748952	2022-10-19	2023-07-10	外观设计	原始取得	无
31	杭州众硅		欧盟	DM/226149	2022-10-19	2022-10-19	外观设计	原始取得	无
32	杭州众硅	抛光研磨装置	美国	US D1,018,613 S	2022-10-19	2024-03-19	外观设计	原始取得	无
33	杭州众硅		韩国	DM/226151	2022-10-19	2023-11-28	外观设计	原始取得	无
34	杭州众硅		新加坡	DM/226151	2022-10-19	2022-10-19	外观设计	原始取得	无
35	杭州众硅		日本	1748953	2022-10-19	2023-07-10	外观设计	原始取得	无
36	杭州众硅		欧盟	DM/226151	2022-10-19	2022-10-19	外观设计	原始取得	无
37	杭州众硅	一种处理导电型晶圆衬底的电化学机械抛光及平坦化设备	美国	US 12,017,293 B2	2023-01-19	2024-06-25	发明	原始取得	无
38	杭州众硅		欧盟	EP 4364890	2023-03-15	2025-07-02	发明	原始取得	无
39	杭州众硅		韩国	10-2819458	2023-03-30	2025-06-09	发明	原始取得	无
40	杭州众硅		日本	7688074	2023-05-30	2025-05-26	发明	原始取得	无
41	杭州众硅	用于清洗晶圆的排列式兆声清洗装置	日本	3253377	2022-11-09	2025-10-16	实用新型	原始取得	无

42	杭州众硅	多晶圆刷洗装置	日本	7660959	2022-11-09	2025-04-04	发明	原始取得	无
43	杭州众硅	用于晶圆的寻位装置、寻位方法及晶圆计速方法	日本	7788191	2022-11-09	2025-12-10	发明	原始取得	无
44	杭州众硅	抛光垫修整装置	日本	7773262	2022-12-30	2025-11-11	发明	原始取得	无
45	杭州众硅	一种晶圆抛光系统及晶圆传输方法	日本	7773261	2022-12-30	2025-11-11	发明	原始取得	无
46	杭州众硅	抛光垫表面状况在线检测方法 & 检测系统	韩国	10-2904378	2024-06-13	2025-12-22	发明	原始取得	无
47	杭州众硅	晶圆抛光系统、装载方法及其使用方法	韩国	10-2816529	2024-07-17	2025-05-29	发明	原始取得	无
48	杭州众硅	抛光研磨装置 (ECMP 外观)	韩国	DM/237809	2024-05-23	2025-02-17	外观设计	原始取得	无
49	杭州众硅		加拿大	231357	2024-05-23	2025-04-03	外观设计	原始取得	无
50	杭州众硅		日本	1790565	2024-05-23	2025-01-27	外观设计	原始取得	无
51	杭州众硅		欧盟	DM/237809	2024-05-23	2024-07-11	外观设计	原始取得	无
52	杭州众硅		韩国	DM/240665	2024-08-29	2025-07-25	外观设计	原始取得	无
53	杭州众硅	抛光研磨装置 (TANAS,EFE MT 形)	日本	1794400	2024-08-29	2025-03-17	外观设计	原始取得	无
54	杭州众硅		日本	1799656	2024-08-29	2025-05-19	外观设计	原始取得	无
55	杭州众硅		欧盟	DM/240665	2024-08-29	2024-10-28	外观设计	原始取得	无
56	杭州众硅	包含可移动装卸模组的研磨装卸构件模组及其晶圆传输方法	中国台湾	I 731281	2018-11-26	2021-06-21	发明	原始取得	无
57	杭州众硅	可挠性的抛光装卸部件模组及晶圆传输的方法	中国台湾	I 739048	2018-11-19	2021-09-11	发明	原始取得	无
58	杭州众硅	CMP 制程的晶圆装载支架、晶圆装载系统及晶圆装片方法	中国台湾	I 713141	2019-11-25	2020-12-11	发明	原始取得	无
59	杭州众硅	化学机械研磨设备	中国台湾	I 806931	2018-11-22	2023-07-01	发明	原始取得	无

60	杭州众硅	化学机械平坦化晶圆传输设备及其使用方法	中国台湾	I 717119	2019-11-22	2021-01-21	发明	原始取得	无
61	杭州众硅	晶圆传输机械手及其晶圆翻转方法	中国台湾	I 773943	2019-11-25	2022-08-11	发明	原始取得	无
62	杭州众硅	CMP 晶圆清洗设备	中国台湾	I 695422	2018-11-20	2020-06-01	发明	原始取得	无
63	杭州众硅	清洗刷预清洗系统	中国台湾	I 757924	2020-10-22	2022-03-11	发明	原始取得	无
64	杭州众硅	晶圆清洗干燥装置	中国台湾	I 837429	2020-10-22	2024-04-01	发明	原始取得	无
65	杭州众硅	一种处理导电型晶圆基底的电化学机械研磨及平坦化设备	中国台湾	I 851146	2023-04-14	2024-08-01	发明	原始取得	无
66	杭州众硅	晶圆传输设备、化学机械平坦化装置及晶圆传输方法	中国台湾	I 734635	2020-10-22	2021-07-21	发明	原始取得	无
67	杭州众硅	可隔离防护晶圆的晶圆处理装置	中国台湾	I 823141	2021-09-08	2023-11-21	发明	原始取得	无
68	杭州众硅	抛光装置	中国台湾	I 815179	2021-09-08	2023-09-11	发明	原始取得	无
69	杭州众硅	一种晶圆位置检测装置	中国台湾	I 794963	2021-09-08	2023-03-01	发明	原始取得	无
70	杭州众硅	一种用于 CMP 清洗单元搬运晶圆的机械手及方法	中国台湾	I 787998	2021-09-08	2022-12-21	发明	原始取得	无
71	杭州众硅	一种化学机械抛光设备及其晶圆缓存装置和晶圆缓存方法	中国台湾	I 834990	2021-09-08	2024-03-11	发明	原始取得	无
72	杭州众硅	一种标定抛光头和装卸台工作位置的装置和方法	中国台湾	I 816394	2022-05-11	2023-09-21	发明	原始取得	无
73	杭州众硅	一种修整头旋转部件、抛光垫修整头和修整器	中国台湾	I 801997	2021-09-08	2023-05-11	发明	原始取得	无
74	杭州众硅	多工位夹取装置	中国台湾	I 816180	2021-09-08	2023-09-21	发明	原始取得	无
75	杭州众硅	晶圆清洗干燥方法及晶圆清洗干燥机构	中国台湾	I 803379	2022-07-01	2023-05-21	发明	原始取得	无
76	杭州众硅	晶圆抛光系统	中国台湾	I 825934	2022-08-22	2023-12-11	发明	原始取得	无

77	杭州众硅	一种晶圆研磨装置	中国台湾	I 829054	2021-12-23	2024-01-11	发明	原始取得	无
78	杭州众硅	用于清洗晶圆的排列式兆声清洗装置	中国台湾	I 839861	2022-09-26	2024-04-21	发明	原始取得	无
79	杭州众硅	多晶圆刷洗装置	中国台湾	I 808023	2022-10-14	2023-07-01	发明	原始取得	无
80	杭州众硅	晶圆寻位方法	中国台湾	I 816576	2022-10-14	2023-09-21	发明	原始取得	无
81	杭州众硅	晶圆抛光系统	中国台湾	I 818688	2022-08-23	2023-10-11	发明	原始取得	无
82	杭州众硅	晶圆驱动机构	中国台湾	I 817770	2022-10-14	2023-10-01	发明	原始取得	无
83	杭州众硅	站立式晶圆卡座	中国台湾	I 857368	2022-10-17	2024-10-01	发明	原始取得	无
84	杭州众硅	一种抛光垫修整装置	中国台湾	I 820968	2022-10-17	2023-11-01	发明	原始取得	无
85	杭州众硅	一种晶圆抛光系统及晶圆传输方法	中国台湾	I 834448	2022-12-23	2024-03-01	发明	原始取得	无
86	杭州众硅	一种抛光垫表面状况在线检测方法 & 检测系统	中国台湾	I 829393	2022-10-17	2024-01-11	发明	原始取得	无
87	杭州众硅	一种晶圆抛光系统、其装载方法及使用方法	中国台湾	I 823623	2022-10-17	2023-11-21	发明	原始取得	无
88	杭州众硅	晶圆清洁干燥模块状态检测方法、装置及平坦化设备	中国台湾	I 874908	2023-02-09	2025-03-01	发明	原始取得	无
89	杭州众硅	一种晶圆旋转机构、晶圆旋转夹持机构及晶圆清洗干燥系统	中国台湾	I 838117	2023-02-07	2024-04-01	发明	原始取得	无
90	杭州众硅	化学机械平坦化设备及晶圆传输方法	中国台湾	I 896992	2023-06-29	2025-09-11	发明	原始取得	无
91	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 225666	2022-09-07	2023-06-01	外观设计	原始取得	无
92	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 225667	2022-09-07	2023-06-01	外观设计	原始取得	无
93	杭州众硅	涡流终点检测装置及方法	中国台湾	I 854476	2023-02-07	2024-09-01	发明	原始取得	无
94	杭州众硅	一种晶圆抛光系统	中国台湾	I 838116	2023-02-07	2024-04-01	发明	原始取得	无

95	杭州众硅	一种处理导电型晶圆基底的电化学机械研磨及平坦化设备	中国台湾	I 851146	2023-04-14	2024-08-01	发明	原始取得	无
96	杭州众硅	一种用于 CMP 设备的电化学机械研磨系统	中国台湾	I 869019	2023-11-02	2025-01-01	发明	原始取得	无
97	杭州众硅	研磨垫再利用加工装置	中国台湾	I 899689	2023-11-03	2025-10-01	发明	原始取得	无
98	杭州众硅	一种导电型研磨头固定装置及导电型研磨头系统	中国台湾	I 866602	2023-11-10	2024-12-11	发明	原始取得	无
99	杭州众硅	导电吸附膜及抛光头	中国台湾	I 845382	2023-07-21	2024-06-11	发明	原始取得	无
100	杭州众硅	一种用于 CMP 设备研磨垫沟槽修整的方法	中国台湾	I 869022	2023-11-02	2025-01-01	发明	原始取得	无
101	杭州众硅	晶圆研磨系统及晶圆处理方法	中国台湾	I 886965	2024-05-20	2025-06-11	发明	原始取得	无
102	杭州众硅	可调式晶圆装卸台	中国台湾	I 896134	2024-05-20	2025-09-01	发明	原始取得	无
103	杭州众硅	用于改善边缘研磨均匀性的研磨装置	中国台湾	I 900014	2024-05-21	2025-10-01	发明	原始取得	无
104	杭州众硅	一种用于 CMP 清洁干燥模组的检测装置及检测方法	中国台湾	I 886962	2024-05-17	2025-06-11	发明	原始取得	无
105	杭州众硅	一种化学机械研磨及平坦化系统	中国台湾	I 891372	2024-05-17	2025-07-21	发明	原始取得	无
106	杭州众硅	一种电化学机械研磨及平坦化装置	中国台湾	I 896171	2024-06-18	2025-09-01	发明	原始取得	无
107	杭州众硅	一种研磨头清洗方法及清洗装置	中国台湾	I 863868	2024-05-17	2024-11-21	发明	原始取得	无
108	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 234468	2024-05-22	2024-10-21	外观设计	原始取得	无
109	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 240377	2024-11-15	2025-09-11	外观设计	原始取得	无
110	杭州众硅	抛光研磨装置	中国台湾	D 241113	2024-11-15	2025-10-21	外观设计	原始取得	无
111	杭州众硅	化学机械抛光的在线监测装置	中国台湾	I 862202	2023-10-03	2024-11-11	发明	原始取得	无
112	杭州众硅	晶圆研磨系统	中国台湾	I 892653	2024-05-20	2025-08-01	发明	原始取得	无

113	杭州众硅	晶圆抛光系统、安装方法及使用方法	日本	7736360	2023-01-09	2025-09-01	发明	原始取得	无
114	杭州众硅	立式晶圆盒	日本	3253988	2022-12-30	2025-12-04	实用新型	原始取得	无

5、域名

序号	网站名称	许可证号	注册日期	到期日期
1	sizonetech.com	浙 ICP 备 18044783 号-2	2018/11	2032/11

（三）企业申报的表外资产的类型、数量

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，除上述申报的无形资产外，企业申报的评估范围内无其他表外资产。

（四）引用其他机构出具的报告的结论所涉及的资产类型、数量和账面金额

本次评估报告中基准日各项资产及负债账面值系普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 27 日出具的标准无保留意见的《审计报告》（普华永道中天特审字(2026)第 0065 号）审计结果，评估是在企业经过审计后的基础上进行的。

除此之外，未引用其他机构报告内容。

四、价值类型

依据本次评估目的，确定本次评估的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、评估基准日

本项目资产评估的基准日是 2025 年 12 月 31 日。

委托人为本次资产评估工作拟订了时间表，为了加快整体工作的进程，同时考虑到评估基准日尽可能与本次评估目的的实现日接近的需要

和完成评估工作的实际可能，经与各方协商，确定评估基准日为 2025 年 12 月 31 日。

六、评估依据

本次资产评估遵循的评估依据主要包括经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、资产权属依据，及评定估算时采用的取价依据和其他参考资料等，具体如下：

（一）经济行为依据

1、《中微半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

（二）法律法规依据

1、《中华人民共和国资产评估法》（2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；

2、《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订）；

3、《中华人民共和国民法典》（2020 年 5 月 28 日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过）；

4、《中华人民共和国企业所得税法》（2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过）；

5、《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订）；

6、《中华人民共和国著作权法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于 2020 年 11 月 11 日通过）；

7、《中华人民共和国专利法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于 2020 年 10 月 17 日通过）；

8、《中华人民共和国商标法》（2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正）；

9、《中华人民共和国增值税法》（2024年12月25日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过）；

10、财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）；

11、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）；

12、《上市公司证券发行注册管理办法》（2023年2月17日中国证券监督管理委员会第2次委务会议审议通过，根据2025年2月19日中国证券监督管理委员会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正）；

13、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会令第73号，2020年2月14日修订）；

14、其他与评估工作相关的法律、法规和规章制度等。

（三）评估准则依据

1、《资产评估基本准则》（财资〔2017〕43号）；

2、《资产评估职业道德准则》（中评协〔2017〕30号）；

3、《资产评估执业准则——资产评估程序》（中评协〔2018〕36号）；

4、《资产评估执业准则——资产评估方法》（中评协〔2019〕35号）；

5、《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协〔2018〕35号）；

6、《资产评估执业准则——企业价值》（中评协〔2018〕38号）；

7、《资产评估执业准则——机器设备》（中评协〔2017〕39号）；

8、《资产评估执业准则——无形资产》（中评协〔2017〕37号）；

9、《资产评估执业准则——知识产权》（中评协〔2023〕14号）；

10、《资产评估执业准则——资产评估委托合同》（中评协〔2017〕33

号)；

11、《资产评估执业准则——资产评估档案》(中评协[2018]37号)；

12、《资产评估执业准则——利用专家工作及相关报告》(中评协[2017]35号)；

13、《资产评估机构业务质量控制指南》(中评协[2017]46号)；

14、《资产评估价值类型指导意见》(中评协[2017]47号)；

15、《资产评估对象法律权属指导意见》(中评协[2017]48号)；

16、《专利资产评估指导意见》(中评协[2017]49号)；

17、《著作权资产评估指导意见》(中评协[2017]50号)；

18、《商标资产评估指导意见》(中评协[2017]51号)；

19、其他与评估工作相关的准则等。

(四) 资产权属依据

1、重要资产购置合同或凭证；

2、权属证书(软件著作权证书、专利证书等)；

3、其他参考资料。

(五) 取价依据

1、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《专项审计报告》(普华永道中天特审字(2026)第0065号)；

2、《2025机电产品报价手册》(机械工业信息研究院)；

3、中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2025年12月20日公布的贷款市场报价利率；

4、委托人和被评估单位依法提供的审计报告、财务会计报表、资产申报明细表和和有关资产初始计量资料；

5、其他参考资料。

(六) 其它参考资料

- 1、Wind 金融数据终端;
- 2、《投资估价》([美]Damodaran 著, [加]林谦译, 清华大学出版社);
- 3、《价值评估: 公司价值的衡量与管理(第 3 版)》([美]Copeland, T.等著, 郝绍伦, 谢关平译, 电子工业出版社);
- 4、《资产评估常用数据与参数手册》(机械工业出版社 2011 版);
- 5、《企业会计准则——基本准则》(财政部令 33 号, 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布, 2014 年 7 月修订版)及《企业会计准则第 1 号-存货》等 41 项具体准则;
- 6、《资产评估专家指引第 8 号——资产评估中的核查验证》(中评协[2019]39 号);
- 7、其他参考资料。

七、评估方法

(一) 评估方法简介

依据《资产评估执业准则——企业价值》(中评协[2018]38 号)和《资产评估执业准则——资产评估方法》(中评协[2019]35 号)的规定, 执行企业价值评估业务, 应当根据评估目的、评估对象、价值类型、评估方法的适用条件、评估方法应用所依据数据的质量和数量等情况, 分析收益法、市场法和资产基础法三种基本方法的适用性, 选择评估方法。

企业价值评估中的收益法, 是指将预期收益资本化或者折现, 确定评估对象价值的评估方法。资产评估专业人员应当结合企业性质、资产规模、历史经营情况、未来收益可预测情况、所获取评估资料的充分性, 恰当考虑收益法的适用性。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。资产评估专业人员应当根据所获取可比企业经营和财务数据的充分性和可靠性、可收集到的可比企业数量，考虑市场法的适用性。

企业价值评估中的资产基础法是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及表外可识别的各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

（二）评估方法选择

本次评估目的是中微半导体设备（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买杭州众硅电子科技有限公司股权。

资产基础法从企业购建角度反映了企业的价值，为经济行为实现后企业的经营管理及考核提供了依据，因此本次评估选择资产基础法进行评估。

国外半导体设备行业经过多年发展，市场集中度高、盈利模式成熟且稳定，龙头企业已形成较为稳定的现金流。而鉴于中国大陆半导体设备尤其是 CMP（化学机械抛光设备）公司业务起步较晚，成熟度远低于国外，当前全球 CMP 行业被美国应用材料、日本荏原主导，两者市占率 8 成以上。

在国外对半导体核心技术封锁的背景下，被评估单位成立时间不长，部分产品仍处于客户验证阶段。此外叠加近年来下游半导体行业周期性的影响，难以对公司在可预见年限内预测其收益与风险水平。因此，本次不适宜采用收益法评估。

因国内产权交易市场交易信息的获取途径有限，且同类企业在产品结构 and 主营业务构成方面差异较大，结合本次评估被评估单位的特殊性，选取同类型市场参照物的难度极大，故本次评估未采用交易案例比较法；

同时考虑到与被评估单位处于同一行业，产品类型、业务结构、主要经营模式相类似的上市公司数量较多，可比公司股价及经营和财务数据相关信息公开，具备资料的收集条件，故本次评估选择采用可比上市公司比较法。

综上，本次评估确定采用资产基础法、市场法进行评估。

(三) 资产基础法

资产基础法，是指以被评估单位或经营体评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及表外可识别的各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，具体是指将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业价值的方法。

各类资产及负债的评估方法如下：

1、流动资产

(1) 货币资金：包括银行存款和其他货币资金

1) 银行存款

对银行存款人民币账户进行了函证复核，以证明银行存款的真实存在，同时检查有无未入账的银行款项，以及评估基准日后的进账情况。

对外币账户，以核实后的基准日外币存款账户金额乘以外汇汇率确认评估值。外汇汇率以基准日中国外汇交易中心公布的相应外币结算价汇率为准。银行存款以核实后账面值确定评估值。

2) 其他货币资金

其他货币资金为 ETC 信用保证金。评估人员核对了账簿记录、查阅了客户交易月报及相关资料，核实交易事项的真实性、业务内容和金额等，核实结果账、表、单金额相符，所以本次评估按清查核实后账面值确认评估值。

(2) 交易性金融资产

交易性金融资产主要为理财产品，评估人员取得理财产品的购买合同，抽查了部分原始凭证等相关资料，以证明银行理财产品真实存在。对银行理财产品以基准日核实后的持仓份额乘每股净值确定评估值。

(3) 应收类账款

对应收类账款的评估，评估人员在对应收类账款核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，应收类账款采用个别认定及组合计提的方法评估风险损失。对关联方的往来款项，评估风险坏账损失的风险为 0；对于组合计提部分款项，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和预期信用损失率，计算预期信用损失。

按以上标准，确定评估风险损失，以应收账款合计减去评估风险损失后的金额确定评估值。坏账准备按评估有关规定评估为零。

(4) 应收票据

对应收票据的评估，评估人员核查时，核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅核对票据票面金额、发生时间、业务内容及票面利率等与账务记录的一致性，以证实应收票据的真实性、完整性，核实结果账、表、单金额相符。经核实应收票据真实，金额准确，未计利息，以核实后账面值确定评估值。

(5) 预付账款

对预付账款的评估，评估人员在对预付款项核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，未发现供货单位有破产、撤销或不能按合同规定按时提供货物或劳务等情况，以核实后的账面值作为评估值。

(6) 存货

纳入本次评估范围内的存货包含原材料、委托加工物资、产成品、在产品及发出商品。

1) 原材料

原材料因耗用量大,周转速度较快,且主要为基准日近期采购,账面值接近基准日市价,故按账面确定评估值。部分原材料库龄较长,已计提存货跌价准备,本次评估按照现行市价确认评估值。

2) 委托加工物资

委托加工物资主要为基准日近期委托,账面值接近基准日市价,故按账面确定评估值。部分委托加工物资时间较长,已计提委托加工物资跌价准备,本次评估按照现行市价确认评估值。

3) 产成品

产成品按实际成本记账,主要为各类自制模组等,后续主要去向为研发领用。产成品成本组成内容为生产领用的材料、辅助材料,分摊的制造费用和人工费用等,由于生产周期较短,成本升降变化不大,成本结转及时完整,故按核实后的账面值确认评估值。

4) 在产品

在产品按实际成本记账,其成本组成内容为生产领用的材料、辅助材料,分摊的制造费用和人工费用等,主要为各类模组及设备半成品。

清查时,评估人员查阅了相关账簿记录和原始凭单,以确认在产品的真实存在及所有权归属。再次,对在产品采取核实采购发票、入库单、出库单、材料及成本核算账簿等账务记录,来判断在产品的真实性和核算的准确性。

对于正常流转的在产品,由于生产周期较短,成本升降变化不大,成本结转及时完整,故按核实后的账面值确认评估值。

5) 发出商品

发出商品主要为发出的 **CMP** 设备。经查企业产品均为正常销售,在

清查核实的基础上评估人员对企业提供的资料分析,对于发出商品以其完全成本为基础,采用市场价格确定评估值。

评估价值=实际数量×不含税售价×(1-产品销售税金及附加费率-销售费用率-营业利润率×所得税率-营业利润率×(1-所得税率)×r)-后续投入成本

a.不含税售价:不含税售价是按照评估基准日前后的市场价格确定的;

b.产品销售税金及附加费率主要包括以增值税为税基计算交纳的城市建设税、教育附加、印花税等与产品销售相关的税金与销售收入的比

例;

c.销售费用率是按各项销售费用与销售收入的比

例平均计算;

d.营业利润率:考虑到被评估单位仍处于亏损,本次按行业营业利润率计算;

e.所得税率按企业现实执行的税率;

f.r为一定的率,由于发出商品已销售,根据基准日调查情况及基准日后实现销售的情况确定其风险r;

g.后续投入成本主要设备调试期至验收前的料工费投入成本。

(7) 其他流动资产

其他流动资产为待抵扣进项税。评估人员在对其他流动资产核实无误的基础上,借助于历史资料和现在调查了解的情况,具体分析数额,以核实后账面值作为评估值。

2、非流动资产

(1) 长期股权投资

对长期股权投资,首先对长期投资形成的原因、账面值和实际状况等进行了取证核实,并查阅了投资协议、股东会决议、章程和有关会计记录等,以确定长期投资的真实性和完整性。

对于全资及控股子公司，对被投资单位评估基准日的整体情况进行了评估。本次评估范围内的被投资单位，成立时间较短，对被投资单位分别进行分析，根据实缴情况、所处阶段、经营情况分别进行评估。

(2) 固定资产

根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合委估设备的特点和收集资料情况，主要采用市场法和重置成本法进行评估。

1) 重置成本法

评估值 = 重置全价 × 成新率

① 重置全价的确定

设备的重置全价，在设备购置价的基础上，考虑该设备达到正常使用状态下的各种费用（包括购置价、运杂费、安装调试费和资金成本等），综合确定：

重置全价 = 设备购置费（不含税）+ 运杂费（不含税）+ 安装调试费（不含税）+ 其他费用（不含税）+ 资金成本

A. 机器设备重置全价

a. 购置价

主要通过向生产厂家或贸易公司询价或参照《2025 机电产品价格信息查询系统》等价格资料，以及参考近期同类设备的合同价格确定。对少数未能查询到购置价的设备，采用同年代、同类别设备的价格变动率推算确定购置价。

对与国产设备技术水平近似的进口设备的现价，根据替代原则，即查找国内功能及技术参数相当的替代设备，查询类似国产设备的恰当的市场交易价格，以确定其购置价。

根据国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财

政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号) 文件规定, 符合增值税抵扣条件的机器设备重置成本应该扣除相应的增值税。本次评估对于设备购置价、运杂费、安装费、基础费按其对应的增值税率测算可抵扣进项税额(下同)。故本次评估机器设备的购置价采用不含税价。

b. 运杂费

以含税购置价为基础, 根据生产厂家与设备所在地间发生的装卸、运输、保管、保险及其他相关费用, 按不同运杂费率计取, 同时, 按国家税收优惠政策扣减应抵扣的增值税。购置价格中包含运输费用的不再计取运杂费。

c. 安装调试费

根据设备的特点、重量、安装难易程度, 以含税购置价为基础, 按不同安装费率计取, 并扣除可抵扣的增值税。

对小型、无须安装的设备 and 购置价中包含安装调试费的, 不再计取安装调试费。

d. 其他费用

其他费用包括管理费、可行性研究报告及评估费、设计费、工程监理费等, 是依据该设备所在地建设工程其他费用标准, 结合本身设备特点进行计算。本次评估范围内设备为航空维修类机器设备, 设备技术要求高, 但无需大型安装工程, 本次评估无需计算其他费用。

e. 资金成本

资金成本按照被评估企业的合理建设工期, 参照评估基准日中国人民银行发布的同期金融机构人民币贷款基准利率, 以设备购置价、运杂费、安装工程费、前期及其他费用等费用总和为基数按照资金均匀投入计取。资金成本计算公式如下:

资金成本 = (设备购置价 + 运杂费 + 基础费 + 安装工程费 + 前期及其他费用) × 合理建设工期 × 贷款基准利率 × 1/2

B.车辆重置全价

根据当地汽车销售信息等近期车辆市场价格资料,确定运输车辆的现行含税购置价,在此基础上根据《中华人民共和国车辆购置税法》规定计入车辆购置税、新车上户牌照手续费等,对于符合增值税抵扣条件的企业,其车辆重置全价为:

重置全价 = 购置价 + 车辆购置税 + 牌照等杂费 - 可抵扣的增值税

a.车辆购置价:根据车辆市场信息及《太平洋汽车网汽车报价库》,《易车网》等近期车辆市场价格资料,参照车辆所在地同类车型最新交易的市价确定本次评估车辆购置价格;对购置时间较长,现不能查到原型号规格的车辆购置价格时参考相类似、同排量车辆价格作为评估车辆购置价参考价格。

b.车辆购置税:根据《中华人民共和国车辆购置税法》的有关规定:车辆购置税应纳税额 = 计税价格 × 10%。故:购置附加税 = 购置价 × 10%。

c.新车上户牌照手续费等:根据车辆所在地该类费用的内容及金额确定。

C.电子设备重置全价

评估范围内的电子设备价值量较小,不需要安装(或安装由销售商负责)以及运输费用较低,参照现行市场购置的价格确定。根据国家发布的税收优惠政策,企业购入的符合规定的固定资产所支付的增值税进项税可以抵扣(包括进口设备进口环节增值税),本次项目根据国家税收优惠政策采用不含税价格确定购置价。

重置全价计算公式:

重置全价 = 设备购置费(不含税)

②成新率的确定

A.机器设备及电子设备成新率:

按照设备的经济使用寿命、现场勘察情况预计设备尚可使用年限,

并进而计算其成新率。其公式如下:

$$\text{成新率} = \text{尚可使用年限} / (\text{实际已使用年限} + \text{尚可使用年限}) \times 100\%$$

对价值量较小的一般设备则采用直接年限法确定其成新率。

B. 车辆成新率

对于运输车辆,根据《机动车强制报废标准规定》(商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号)的有关规定和车辆的平均经济使用年限,按以下方法确定成新率后取其较小者为最终成新率,即:

$$\text{使用年限成新率} = (1 - \text{已使用年限} / \text{规定或经济使用年限}) \times 100\%$$

$$\text{行驶里程成新率} = (1 - \text{已行驶里程} / \text{规定行驶里程}) \times 100\%$$

$$\text{成新率} = \text{Min}(\text{使用年限成新率}, \text{行驶里程成新率})$$

同时对待估车辆进行必要的勘察鉴定,若勘察鉴定结果与按上述方法确定的成新率相差较大,则进行适当的调整,若两者结果相当,则不进行调整。

③ 评估值的确定

$$\text{评估值} = \text{重置全价} \times \text{成新率}$$

(3) 使用权资产

对于使用权资产的评估,评估人员查阅了相关的租赁合同、核对明细账与总账、报表余额是否相符,查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录。在核实无误的基础上,按照基准日尚存在的剩余资产或权益作为评估值。

(4) 无形资产

1) 专利、软件著作权

A. 评估方法选择

专利及软件著作权常用评估方法包括收益法、市场法和成本法。

市场法主要通过活跃专利及软件著作权市场或资本市场上选择相同或相似的专利及软件著作权作为参照物,同时针对各种价值影响因

素，如专利及软件著作权的功能进行类比，将被评估专利及软件著作权与参照物进行价格差异的比较调整，分析各项调整结果，从而确定专利及软件著作权的价值。使用市场法评估专利及软件著作权的必要前提包括：市场数据公开化程度较高；存在可比的专利技术；参照物的价值影响因素明确且能够量化等。由于我国专利及软件著作权市场交易目前尚处于初级阶段，类似专利及软件著作权的公平交易数据采集较为困难，市场法在本次评估应用中可操作性较差。

成本法通过分析重新开发出被评估专利及软件著作权所需花费的物化劳动来确定评估价值。企业合法取得专利及软件著作权过程中需支出的费用一般包括人工费用、调研咨询费、资产购置费、实验测试费、期间费用等，专利及软件著作权技术赋予企业的真实价值，与企业实际所支出费用之间通常对应关系较弱，故成本法评估通常适用于经营与收益之间不存在较稳定的对应关系，相应产品或服务价格市场性较弱的专利及软件著作权评估。本次评估的专利及软件著作权是被评估单位多年研究、实验的成果，在本次评估过程中，被评估单位向评估人员提供了其历史成本投入情况，因此可以采用成本法进行评估。

收益法以被评估专利及软件著作权未来所能创造的收益现值来确定评估价值，对专利及软件著作权等无形资产而言，其价值主要来源于直接变卖该等无形资产的收益，或者通过使用该等无形资产为其产品或服务注入技术加成而实现的超额收益。本次评估，考虑到国外半导体设备行业经过多年发展，市场集中度高、盈利模式成熟且稳定，龙头企业已形成较为稳定的现金流。

鉴于中国大陆半导体设备尤其是 CMP（化学机械抛光设备）公司业务起步较晚，成熟度远低于国外，当前全球 CMP 行业被美国应用材料、日本荏原主导，两者市占率 8 成以上。在国外对半导体核心技术封锁的背景下，被评估单位成立时间不长，部分产品仍处于客户验证阶段。此

外叠加近年来下游半导体行业周期性的影响，难以对公司在可预见年限内预测其收益与风险水平。因此，本次不适宜采用收益法评估。

B. 成本法概述

专利及软件著作权成本主要由其研制中投入的物化劳动，如消耗的专项原辅材料等资源、占用的仪器、设备和场所以及设计服务等费用；及其投入的相关劳动费用，如研制开发人员的工资、劳务和福利费用等费用所构成。专利及软件著作权所占用的研发费用至少应达到同行业的平均收益率才能够体现其使用价值。专利及软件著作权因更新换代等因素被新的技术代替，将导致其技术的技术性贬值。

专利及软件著作权的评估模型为

$$A=B \times (1-Q)$$

A: 专利及软件著作权评估值

B: 研发费用与研发费用投资回报之和

Q: 技术的贬值率

$Q = \text{技术已使用年限} / (\text{技术已使用年限} + \text{预计尚可使用时间})$

2) 商标

纳入本次评估范围内的账外无形资产商标权，申请注册相对简单，均对企业收入贡献不大，不直接产生收益故采用成本法评估，依据商标权无形资产形成过程中所需投入的各种成本费用的重置价值确认商标权价值，其基本公式如下：

$$P=C_1+C_2+C_3$$

式中：P：评估值

C₁：设计成本

C₂：注册费用（包括注册代理费）及其他成本

C₃：维护使用成本

3) 域名

经核实域名注册过程中的合理支出，按其合理支出确定评估值。其基本公式如下：

$$P=C_1+C_2$$

式中：

P：评估值

C₁：注册域名 1 年要花费的注册费用

C₂：域名注册 1 年后到终止日所花费的费用

4) 外购软件

对于外购软件，评估人员查阅相关的证明资料并查阅了原始合同，了解原始入账价值的构成，摊销的方法和期限，查阅了原始合同。经核实表明账、表金额相符。通过向软件供应商询价或网络查询其现行不含税价格确定评估值。

(5) 长期待摊费用

对于长期待摊费用，评估人员抽查了原始入账合同、收据等核实其核算内容的真实性和完整性。对于在未来受益期内仍可享受相应权益或资产长期待摊费用，按尚存受益期应分摊的余额确定评估值。

(6) 其他非流动资产

其他非流动资产为大额存单及利息，评估人员在对其他非流动资产核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额，以核实后账面值作为评估值。

3、负债

检验核实各项负债在评估目的实现后的实际债务人、负债额，以评估目的实现后的产权所有者实际需要承担的负债项目及金额确定评估值。

(四) 市场法

1、概述

根据《资产评估执业准则—企业价值》，企业价值评估中的市场法，是指将被评估单位与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定被评估单位价值的评估方法。

（1）市场法的应用前提

运用市场法评估股东全部权益价值需要满足如下基本前提条件：

1) 要有一个充分发展、活跃的、公开的市场，在这个市场上成交价格基本上反映市场买卖双方的行情，因此可以排除个别交易的偶然性。

2) 在这个公开市场上要有可比的企业及其交易活动，且交易活动应能较好反映股东全部权益价值的趋势。企业及其交易的可比性是指选择的可比企业及其交易活动是在近期公开市场上已经发生过的，且与被评估的目标企业及其即将发生的业务活动相似。

3) 参照物与被评估单位的价值影响因素明确，可以量化，相关资料可以搜集。

（2）市场法选择的理由和依据

市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

被评估单位主营业务为高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备的研发、制造和销售。由于该行业具有一定技术壁垒，导致行业内同业公司相对较少且交易活跃度较低、交易案例数量有限，近年来公开披露的已完成或正在进行中的交易案例较少，交易细节及被并购企业的详细信息难以收集掌握，因此本次未采用交易案例比较法进行估算。

当前证券市场存在较多经营正常稳定、主营业务及产品与被评估单位相似的上市公司，故综合考量后，本次采用上市公司比较法进行估算。

2、评估思路

在充分了解并掌握被评估单位企业性质、业务类型、经营模式、发展阶段、企业规模、财务状况等基本情况的基础上，按以下思路开展市场法评估：

（1）选择可比企业

搜集可比企业信息，通过比较分析筛选出适当数量的可比企业。本次采用上市公司比较法，筛选原则包括：属于同一行业，或者受相同经济因素影响；交易市场相同或可比；有一定时间的上市交易历史，并且近期股票价格没有异动；业务结构、经营模式等方面相近或相似等。

（2）计算价值比率

根据资本市场数据，对被评估单位与可比公司所处行业的价值影响因素（价值因子）进行线性回归分析，并结合行业及企业特点，选择相对合适的价值比率。

根据可比企业于评估基准日的市值（比准市值）及价值因子，计算可比企业价值比率。

（3）计算评估价值

根据被评估单位价值比率、价值因子，同时考虑价值比率数据口径，对非经营性资产（负债）、流动性因素进行调整，得出被评估单位股东全部权益价值。

3、评估模型

本次评估采用上市公司比较法，基本模型为：

$$E=EV+C-D-M$$

E：股东全部权益价值；

C：现金等价物

D: 付息债务

M: 少数股东权益

其中:

$EV = \text{可比公司比准价值比率} \times \text{被评估单价值因子}$

八、评估程序实施过程和情况

整个评估工作分五个阶段进行:

(一) 评估准备阶段

1、委托人召集本项目各中介协调会，有关各方就本次评估的目的、评估基准日、评估范围等问题协商一致，并制订出本次资产评估工作计划。

2、配合企业进行资产清查、填报资产评估申报明细表等工作。评估项目组人员对委估资产进行了详细了解，布置资产评估工作，协助企业进行委估资产申报工作，收集资产评估所需文件资料。

(二) 现场评估阶段

项目组现场评估阶段的主要工作如下:

1、听取委托人及被评估单位有关人员介绍企业总体情况和委估资产的历史及现状，了解企业的财务制度、经营状况、固定资产技术状态等情况。

2、对企业提供的资产评估申报明细表进行审核、鉴别，并与企业有关财务记录数据进行核对，对发现的问题协同企业做出调整。

3、根据资产评估申报明细表，对固定资产、存货以抽查的形式进行盘点。

4、查阅收集委估资产的产权证明文件。

5、根据委估资产的实际状况和特点，确定各类资产的具体评估方法。

6、根据资产评估申报明细表,对主要设备,查阅了技术资料、决算资料和竣工验收资料;对通用设备,主要通过市场调研和查询有关资料,收集价格资料。

7、对企业提供的权属资料进行查验。

8、对评估范围内的资产及负债,在核实的基础上做出初步评估测算。

9、通过对企业现场勘察、参观、以访谈的形式,对被评估企业的经营性资产的现状、规模条件和能力以及历史经营状况、经营收入、成本、期间费用及其构成等的状况进行调查复核。对影响评估作价的主营业务的业务量、业务收入和相关的成本费用等进行了详细调查,查阅了相关的重要合同协议等。在资产核实和尽职调查的基础上,收集相关行业的宏观行业资料以及可比公司的财务资料和市场信息等。

(三) 评估汇总阶段

对各类资产及负债评估的初步结果进行分析汇总,对评估结果进行必要的调整、修改和完善。

(四) 提交报告阶段

在上述工作基础上,起草初步资产评估报告,初步审核后与委托人就评估结果交换意见。在独立分析相关意见后,按评估机构内部资产评估报告审核制度和程序进行修正调整,最后出具正式资产评估报告。

(五) 整理归集阶段

对评估程序实施过程中的档案进行整理归集。

九、评估假设

本次评估中,评估人员遵循了以下评估假设:

(一) 一般假设

1、交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

2、公开市场假设

公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

3、企业持续经营假设

企业持续经营假设是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。对于企业的各类经营性资产而言，能够按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用。

(二) 特殊假设

1、本次评估假设国家政策、经济环境、房地产本身的状况等因素不发生重大变化，委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整，本次评估不考虑通货膨胀因素的影响；

2、企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；

3、被评估单位在未来经营期内管理团队尽职尽责,核心人员保持稳定而不发生重大变化，并继续按照现有的经营管理模式持续经营；

4、本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资

产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；

5、本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；

6、本次评估测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响；

7、可比企业与被评估单位在价值影响因素方面相同或者相似；

8、可比企业与被评估单位均能够按交易时公开披露的经营模式、业务架构、资本结构持续经营；

9、可比上市公司所涉及的交易均为有序市场环境下的公平交易，交易对价公允有效。可比上市公司信息披露真实、准确、完整，无影响价值判断的虚假陈述、错误记载或重大遗漏；

10、评估人员仅基于公开披露的可比企业相关信息选择对比维度及指标，不考虑其他非公开事项对被评估单位价值的影响。

当上述条件发生变化时，评估结果一般会失效。

十、评估结论

我们根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则，本着独立、公正、科学、客观的原则，履行了资产评估法定的和必要的程序，采用资产基础法、市场法进行评估，对杭州众硅电子科技有限公司纳入评估范围的资产实施了实地勘察、市场调查、询证和评估计算，得出如下结论：

（一）资产基础法评估结论

资产账面价值 104,275.53 万元，评估值 139,641.94 万元，评估增值 35,366.41 万元，增值率 33.92%。

负债账面价值 26,755.27 万元，评估值 26,755.27 万元，无评估增减值。

所有者权益账面价值 77,520.26 万元，评估值 112,886.67 万元，评估增值 35,366.41 万元，增值率 45.62%。详见下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2025 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	98,014.37	101,069.60	3,055.23	3.12
非流动资产	6,261.16	38,572.34	32,311.18	516.06
其中：长期股权投资	500.00	500.00	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,437.87	1,872.78	434.92	30.25
在建工程	-	-	-	-
无形资产	29.09	31,905.36	31,876.26	109,562.39
其中：土地使用权	-	-	-	-
其他非流动资产	3,059.67	3,059.67	-	-
资产总计	104,275.53	139,641.94	35,366.41	33.92
流动负债	25,537.84	25,537.84	-	-
非流动负债	1,217.44	1,217.44	-	-
负债总计	26,755.27	26,755.27	-	-
净资产（所有者权益）	77,520.26	112,886.67	35,366.41	45.62

评估结果与账面所有者权益比较增值 35,366.41 万元，增值率 45.62%，主要原因为存货、无形资产、固定资产增值，具体如下：

1、存货账面值为 53,898.75 万元，评估值为 56,953.98 万元，评估增值 3,055.23 万元，增值率 5.67%，增值主要原因是由于产品市场行情较好，发出商品评估值中考虑了部分利润所致。

2、无形资产账面值为 29.09 万元，评估值 31,905.36 万元，评估增值 31,876.26 万元，增值率 109,562.39%，增值原因主要为账外的专利及软著等资产具有使用价值。

3、固定资产账面值为 1,437.87 万元，评估值为 1,872.78 万元，评估增值 434.92 万元，增值率 30.25%，增值原因主要为：本次评估采用的经济使用年限和企业采用的会计折旧年限不同，故造成评估增值。

（二）市场法评估结论

采用市场法估值，合并报表口径下，杭州众硅电子科技有限公司在评估基准 2025 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益账面值 75,280.39 万元，评估值 250,140.00 万元，评估增值 174,859.61 万元，增值率 232.28%。

被评估单位在行业中技术领先，具有技术密集、高技能人才密集的特点，市场法评估中结合评估对象行业发展、收入类型、市场需求等因素变化对未来获利能力的影响，评估结果包含了资源优势、技术优势、管理优势等账外的无形资产，故导致评估结果增值。

（三）评估结果的差异分析

本次评估采用市场法得出的股东全部权益价值为 250,140.00 万元，比资产基础法测算得出的股东全部权益价值 112,886.67 万元，高 137,253.33 万元，差异率 121.59%。两种评估方法差异的原因主要是：

1、资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；

2、上市公司比较法反映了在正常公平交易的条件下公开市场对于评估对象价值的测算，通过选取合适价值比率，模拟估算出评估对象的公开市场交易性的市场价值。

综上所述，从而造成两种评估方法产生差异。

（四）评估结果的选取

杭州众硅电子科技有限公司是一家高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备公司，为半导体行业及其他高科技领域提供优质技术和高效服务。公司的使命是促进全球芯片生产制造工艺技术的发展，集聚了国内外高端人才，拥有强大的专业技术研发团队，旨在为全世界芯片生产厂商提供一流的化学机械平坦化抛光（CMP）设备，为他们提供先进技术和高效的服务，帮助芯片生产厂商解决技术难题。

公司主要从事高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备及周边产品的研发与生产，主要产品包括众硅 TTAIS®150CMP、TTAIS®200CMP、众硅 TTAIS®300 CMP、单模组 CMP 系统、抛光液供液系统（SDS）、ECMP 等产品，以及相关产品的技术服务。

公司的核心竞争力如下：

1、聚焦半导体制造关键核心环节，核心技术自主可控

公司聚焦半导体制造关键核心环节，以技术研发创新为引擎，在 CMP 后清洗技术、终点检测控制技术、APC 智能控制技术、CMP 工艺应用等核心领域实现重大创新突破并完全自主可控。公司是国内少数能够自主创新制造 12 英寸 CMP 设备的企业，其设备采用 6 抛光盘的全新架构设计，突破了目前市场主流设备 4 盘或 3 盘的架构模式。6 抛光盘的设计不仅可同时支持 3 盘工艺或 2 盘工艺，更好匹配先进存储和逻辑芯片制造中多场景工艺需求，为逻辑芯片、存储芯片、功率器件等不同应用领域提供一站式解决方案，凸显“一机多用”的柔性生产优势。同时，产能方面实现了跨越式提升，结合模块化设计带来的快速维护能力，不仅大幅降低设备停机维护时间，更同步提升了运行稳定性与生产效率，为客户构建“高效低耗”的生产体系提供核心支撑。该设备凭借技术创新性与产业化价值，已成功认定为“国内首台（套）装备”，这一认证印证了公司在 CMP 设备领域的技术领先地位，为半导体产业链高端装备国产化提供了关键支撑，具备广阔的市场空间。

2、汇聚国内外高端人才，公司具备持续性创新能力

公司创始团队来自浙江大学、南京大学等国内外知名高校，曾任职于应用材料、瓦里安半导体、屹唐半导体等知名企业。同时，公司组建了一支兼具国际视野与本土深耕能力的团队，团队核心成员行业经验丰富。此外，公司依托前瞻性的科研布局与创新生态，建立有浙江省博士后工作站、浙江省高新技术企业研究开发中心等科研创新平台，引进了

来自国内外名校的硕士、博士人才，逐步形成“人才培养—技术攻关—成果转化”的全链条创新体系，具备持续创新能力。

3、公司客户已覆盖业内知名企业，客户资源优质

集成电路制造企业和碳化硅功率器件厂商对各类半导体专业设备的技术标准和可靠性有着严苛的要求，对设备供应商的选择非常慎重，设备产品一旦验证通过并实际进入生产线，即进入客户的合格供应商名录，后续采购需求相对稳定。经过多年努力，公司自主研发并生产的 CMP 设备已成功进入国内知名先进存储厂商和逻辑芯片制造厂商，取得了良好的市场口碑，与客户建立了良好的合作关系。公司通过与业内知名企业的产品验证过程，对客户的核心需求、行业技术发展趋势理解更为深刻。

4、设备核心模块自研实现自主可控

CMP 设备核心零部件长期以来被国外企业垄断，国内设备厂商依赖进口，面临供应中断、技术封锁等风险。公司已实现了诸如抛光头、旋转接头、电推缸、风机过滤器等关键零部件的自主可控。通过零部件自研形成专利布局，构建技术壁垒，规避国外专利纠纷与技术封锁，摆脱对外部供应链的依赖，并形成了产业链上下游协同，为半导体装备产业链自主可控提供了关键支撑，强化了核心竞争力。同时，关键零部件的自研大幅降低零部件采购与维护成本，同时缩短设备交付与售后响应周期，推动国产 CMP 设备性价比优势凸显，助力国内晶圆厂降低生产成本，加速国产设备自主化发展进程。

由于杭州众硅电子科技有限公司主要产品为高端化学机械平坦化抛光（CMP）设备，市场对于该类企业更多的是看重其研发和未来的发展。市场法参考与被评估单位相似的可比公司近期交易价格，通过分析并调整可比公司与被评估单位各自特点及差异，确定被评估单位评估值，从市场价格的角度测算被评估单位的整体市场价值。因此市场法能够从行

业的发展前景、行业特性等方面反映公司的价值。

通过以上分析，我们选用市场法作为本次被评估单位的定价方法。由此得到杭州众硅电子科技有限公司股东全部权益在基准日时点的市场价值为 250,140.00 万元。

十一、特别事项说明

（一）引用其他机构出具报告结论的情况

本次评估报告中基准日各项资产及负债账面值系普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计结果。评估是在企业经过审计后的基础上进行的。

（二）产权瑕疵事项

截至评估基准日，评估人员发现被评估单位存在仍在申请中的专利及商标，后续可能存在被驳回的风险，提请报告使用者注意。

（三）未决事项、法律纠纷等不确定因素

截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，被评估单位及其子公司不存在重大未决事项、法律纠纷等不确定因素。

（四）抵（质）押及其或有负债、或有资产的性质、金额及其对应资产负债情况

截至评估基准日，被评估单位及其子公司不存在对外担保情况。

（五）重大期后事项

截至报告出具日，被评估单位及其子公司新增 9 项已注册专利，提请报告使用人注意。

（六）其他需要说明的事项

1、截至评估基准日，被评估单位及其子公司存在以下租赁事项：

序号	承租人	出租人	产权证号	租赁地址	面积 (m ²)	租赁用途	租金 (元/月/平方米)	租赁期限
1	杭州众硅	浙江青山湖科研创新基地投资有限公司	浙(2019)临安区不动产权第0015440号	杭州市临安区青山湖街道大园路1155号创业广场A座13、14、15楼	2,995.86	商业办公	30.00	2025-01-16至2026-01-15
2	杭州众硅	浙江钜典药业有限公司	浙(2017)临安市不动产权第0002771号	杭州市临安市青山湖街道创业街88号1幢2层北	1,755.00	厂房及仓储	38.00	2023-05-01至2026-04-30
3				杭州市临安市青山湖街道创业街88号1幢1层北	1,895.40	厂房及仓储	38.00	2022-10-17至2026-04-30
4				杭州市临安市青山湖街道创业街88号1幢1层及其夹层	1,980.00	厂房和办公用房	30.00	2023-07-01至2026-04-30
5	杭州众硅	浙江大学科技园发展有限公司	杭房权证西移字第07546327号	杭州市西湖区西溪路525号浙江大学国家大学科技园西溪园区A楼东区218-219室	304.88	办公	100.50	2025-09-01至2026-08-31
6	上海众硅	上海桥合置业有限公司	沪(2022)浦字不动产权第023918号	上海市浦东新区新金桥路36、56号的上海国际财富中心1幢南塔1805室(15层)	415.07	办公	145.50	2024-12-01至2026-11-30
7	杭州众硅	卓悦商服(广州)产业服务有限公司	粤(2024)广州市不动产权第10067420号	广州市增城区宁西街创新大道14号101第8层802单元	132.89	办公	13.86	2025-12-01至2028-11-30

被评估单位经营场所为租赁，租金水平及租赁情况正常。假设现有租赁状况不变的情况下，被评估单位可继续以租赁方式和合理的租赁价格取得经营场所的使用权持续经营。

2、本报告中所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成，提请报告使用者注意。

3、评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，并不涉及到评估师和评估机构对该项评估目的所对应的经济行为做出任何判断。评估工作在很大程度上，依赖于委托人

及被评估单位提供的有关资料。因此,评估工作是以委托人及被评估单位提供的有关经济行为文件,有关资产所有权文件、证件及会计凭证,有关法律文件的真实合法为前提。

4、本次评估范围及采用的由被评估单位提供的数据、报表及有关资料,委托人及被评估单位对其提供资料的真实性、完整性负责。

5、评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由被评估单位提供,委托人及被评估单位对其真实性、合法性承担法律责任。

6、在评估基准日以后的有效期内,如果资产数量及作价标准发生变化时,应按以下原则处理:

(1)当资产数量发生变化时,应根据原评估方法对资产数额进行相应调整;

(2)当资产价格标准发生变化、且对资产评估结果产生明显影响时,委托人应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估价值;

(3)对评估基准日后,资产数量、价格标准的变化,委托人在资产实际作价时应给予充分考虑,进行相应调整。

十二、评估报告使用限制说明

1、本评估报告只能用于本报告载明的评估目的和用途。同时,本次评估结论是反映被评估单位在本次评估目的下,根据公开市场的原则确定的现行公允市价,没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜,以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响,同时,本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其它情况发生变化时,评估结论一般会失效。评估机构不承担由于这些条件的变化而导致评估结果失效的相关法律责任。

2、本评估报告成立的前提条件是本次经济行为符合国家法律、法规

的有关规定，并得到有关部门的批准。

3、本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用。评估报告的使用权归委托人所有，未经委托人许可，本评估机构不会随意向他人公开。

4、委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

5、除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

6、未征得本评估机构同意并审阅相关内容，评估报告的全部或者部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

7、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

8、根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须委托人按照法律法规要求履行资产评估监督管理程序后使用。评估结果使用有效期一年，即自评估基准日2025年12月31日起至2026年12月30日内使用有效。

十三、评估报告日

评估报告日为二〇二六年三月二十七日。

（此页无正文）



浙江中联资产评估有限公司

资产评估师：



李洪柱

资产评估师：



周承起

二〇二六年三月二十七日

附件

- 1、经济行为文件（复印件）；
- 2、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《普华永道中天特审字(2026)第 0065 号》专项审计报告（复印件）；
- 3、评估明细表；
- 4、委托人和被评估单位企业法人营业执照（复印件）；
- 5、委托人及被评估单位承诺函；
- 6、签字资产评估师承诺函；
- 7、浙江中联资产评估有限公司财政局备案公告（复印件）；
- 8、浙江中联资产评估有限公司企业法人营业执照（复印件）；
- 9、浙江中联资产评估有限公司证券期货相关业务备案名单（复印件）；
- 10、签字资产评估师资格证书（复印件）。